사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도	2010.01.01	부터
	2010.12.31	까지

금융위원회

한국거래소 귀중 2011년 03월 31일

회사명 : 엠케이전자주식회사

대표이사 : 최 윤 성

본점소재지 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리 316-2

(전화) 031-330-1900

(홈페이지) http://www.mke.co.kr

작성책임자 : (직책) 상무이사 (성명) 이 재 홍

(전화) 031-330-1911

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의 2 및 제2조의 3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2011. 03. 31

엠케이이전자주식회사

대표이사 최 윤 성 (서명)

신고업무담당이사 이 재 홍 (서명)

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인· 검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의 2 및 제2조의 3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2011. 03. 31

엠케이전자주식회사

대표이사 최 윤 성 (서명)

신고업무담당이사 이 재 홍 (서명)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 엠케이전자주식회사로 표기합니다.
또한, 영문으로는 MK ELECTRON CO., LTD.로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 1982년 12월에 설립되어, 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
또한, 당사는 1997년 11월에 코스닥시장을 통한 기업공개를 실시하였습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리 316-2번지
전화 : 031-330-1900
홈페이지 : http://www.mke.co.kr

라. 주요사업의 내용

당사는 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품 등을 생산하는 사업을 하고 있으며, 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조 바랍니다.

마. 계열회사에 관한 사항

당사는 지주회사인 (주)오션비홀딩스 기업집단에 편입되어 있으며, 자세한 사항은 "VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 → 4. 계열회사 등의 현항"을 참조 바랍니다.

2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

년월	내용
1982. 12.	법인설립(주식회사 미경사)
1986. 05.	용인공장 준공 및 양산시스템 확립

1986. 09.	기업부설연구소 설립
1997. 11.	코스닥시장 등록
1999. 05.	외국인 투자업체 등록 (UBS Capital - 회사발행주식 61.5% 지분인수)
1999. 10.	용인 신공장 증설
2000. 04.	액면분할(5,000원 → 500원)
2001. 01.	대만영업소 설립
2001. 03.	사업목적 추가(부동산 임대업)
2001. 07.	대표이사 변경(강도원 사임, 김일태 취임)
2004. 02.	대표이사 변경(김일태 사임, 송기룡 취임)
2004. 11.	1억불 수출탑 수상
2004. 12.	중국사무소 설립
2005. 12.	최대주주 변경(에프지텐사모투자전문회사 회사발행주식 52.03% 지분인수)
2006. 10.	최대주주 변경(대우전자부품 컨소시엄 회사발행주식 23.10% 지분인수)
2006. 11.	2억불 수출탑 수상
2006. 12.	대표이사 변경(송기룡 사임, 최상용 취임)
2007. 09.	최대주주 변경(기존 최대주주의 특수관계인 해제로 인해 칸서스제구차유한회사로 변경)
2007. 10.	최대주주 변경(노블레스산업 및 특수관계인 회사발행주식 23.34% 지분인수)
2007. 11.	계열회사 변경(유구광업주식회사 회사발행주식 70% 지분인수)

2008. 10.	계열회사 변경(MK ELECTRON (H.K.) 회사발행주식 100% 취득-홍콩법인 설립)
2008. 11.	3억불 수출탑 수상
2008. 12.	대표이사 변경(최상용 사임, 최윤성 취임)
2009. 03.	최대주주 변경(거암개발 회사발행주식 16.14% 지분인수)
2009. 11	강소성 쿤산(昆山)시에 중국공장 완공
2010. 10	용인 공장 증축 착공
2010. 11	5억불 수출탑 수상

나. 상호의 변경

년월	내용
1997. 07.	"미경사"에서 "엠케이에스주식회사"로 상호변경
1997. 08.	"엠케이에스주식회사"에서 "엠케이전자주식회사"로 상호변경

다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

년월	내용
1983. 04.	Gold Bonding Wire 개발 완료
1983. 12.	Gold Bonding Wire 제조기술에 대한 특허취득 (#15866)
1988. 03.	반도체용 고순도 금 증착재료 및 Gold Base 합금개발(Au Pure, Au-Ge, Au-Ge-Sb, Au-Zn, Au-Sb, Au-Be등)
1988. 09.	반도체용 고순도 Gold Sputtering Target 개발
1990. 05.	열전도용 Pt-Rh 합금개발
1990. 06.	특허등록 "반도체용 세금선 제조 방법"
1991.	Low-Loop용 Gold Wire 개발 (L-Type)

04.	
1994. 02.	Long-Loop용 Gold Wire 개발 (T-Type)
1996. 02.	Gold 합금 Wire 개발 (R-Type)
1999. 06.	국내 최초 BGA용 Solder Ball 양산 및 납품
1999. 09.	특허등록 "반도체 소자의 본딩와이어용 금합금"
1999. 10.	용인 신공장 증설
1999. 11.	특허등록 "Gold-Based Alloy for Bonding Wire of Semiconductor Device" (미국특허청)
2000. 04.	니혼 혼다 기술 개발 체결 (Solder Ball)
2003. 06.	특허등록 "솔더볼의 제조방법 및 장치" (APPARATUS FOR MANUFACTURING SOLDER BALLS)
2003. 09.	특허등록 "본딩 와이어용 스풀 케이스 및 이 케이스를 사용한 스풀 취급 방법" / 특허권자 : 엠케이전자(주) , 헤라우스 오리엔탈하이텍(주)
2004. 03.	특허등록 "본딩와이어 스풀용 자석 부착식 케이스" (CASE FOR CASING THE SPOOL OF BONDING WIRE WITH MAGNETIC ATTRACTION METHOD)
2004. 04.	특허등록 "반도체 소자 본딩용 금-은 합금 와이어" (Gold-Silver Bonding Wire for Semiconductor Device)
2005. 02.	고신뢰성 본딩와이어 개발
2005. 07.	Microbonds X-Wire개발 MOU 체결(최종 합의)
2006. 03.	특허등록 "반도체 소자 본딩용 금 합금 와이어" (Gold Alloy Bonding Wire for Semiconductor Device)
2006. 09.	특허등록 "반도체 소자 본딩용 금 합금세선"
2006. 09.	특허등록 "본딩와이어 제조방법 및 여기에 이용되는 본딩와이어 강화장비"
2007. 06.	부품·소재기술개발사업 선정 - 산업자원부 주관 (기술개발과제명 : 차세대 반도체 패키징용 Fine Pitch Au Bonding Wire 개발)
2007.	Microbonds X-Wire개발 기술도입 본계약 체결

08.	
2007. 10.	특허등록 "PB-FREE SOLDER ALLOY(무연솔더합금)"
2007. 11.	사업목적 추가 - 국내외 자원 탐사 및 개발, 생산, 판매, 수입, 무역업 - 부동산관리 및 자산운용업 - 전자부품 도소매업
2007. 11.	타법인 주식취득에 따른 계열회사 추가 - 유구광업주식회사 지분 70% 취득
2008. 02.	특허등록 "반도체 패키지용 금-은 합금계 와이어"
2008. 08.	중국 반도체시장 진출을 위한 중국 곤산경제기술개발구 관리위원회와 투자협의서 체결
2008. 09.	반도체 패키지用 금-은 합금와이어 세계최초 양산 출시
2008. 10.	타법인 주식취득에 따른 계열회사 추가 - MK ELECTRON (H.K.) 지분 100% 취득(홍콩법인 설립)
2010. 02	타법인 주식취득에 따른 계열회사 추가 - 나노퍼시픽(주) 지분 39.25% 취득
2010. 03	사업목적 추가 - 조명광원 및 기구 제조 및 판매 - 탄소나노튜브 제품 및 응용제품 제조 및 판매 - 탄소섬유 및 탄소복합재료 제조 및 판매 - 백라이트 유니트 제조 및 판매
2011. 03	사업목적 추가 - 문화서비스업 - 레져산업업 - 관광용역 및 관광사업 개발

3. 자본금 변동사항

【증자(감자)현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당	주당발행	비고

				액면가액	(감소)가액	
2006.03.14	주식매수선택권행사	보통주	102,000	500	2,376	-
2006.05.10	유상증자(주주배정)	보통주	1,700,000	500	8,190	-
2006.05.11	무상증자	보통주	4,301,000	500	500	-
2007.02.05	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,470	-
2007.02.09	주식매수선택권행사	보통주	68,000	500	3,470	-
2007.07.16	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,470	-
2007.12.03	무상증자	보통주	6,208,351	500	500	-
2009.11.30	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,982	-

【미상환 신주인수권부사채 등 발행현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상 주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건		미행사신주인수권부사채		비고
						행사비율 (%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수	
엠케이전자주식회사 제1회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	2009.07.08	2012.07.08	15,000,000,000	엠케이전자주식회사 보통주	2010.07.08 ~2012.07.07	100	4,479	15,000,000,000	3,348,961	주1), 주2)
합 계	-	-	15,000,000,000	-	-	100	4,479	15,000,000,000	3,348,961	-

주1) 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득
당사는 2011년 01월 11일 아래와 같이 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득을 하고, 이를 공시한 바 있습니다.
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
 (1) 사채의 종류 : 엠케이전자주식회사 제1회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 (2) 발행일자 : 2009년 07월 08일
 (3) 발행방법 : 국내발행(사모)
 (4) 주당 신주인수권행사가액 : 4,210원
 (5) 분리여부 : 해당
 (6) 만기일 : 2012년 07월 08일
2. 사채 취득금액 : 15,457,500,000원
 (1) 취득한 사채의 권면총액 : 15,000,000,000원
 (2) 취득일자 : 2011년 01월 10일

3. 취득후 사채의 권면잔액 : 없음
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 :
 (1) 만기전 취득사유 : 인수인의 조기상환청구권(Put Option) 행사
 (2) 향후 처리방법 : 취득후 즉시 소각
5. 취득자금의 원천 : 자기자금
6. 사채의 취득방법 : 장외매수
7. 기타 참고할 사항 : 본 사채는 분리형이므로 워런트는 유효함
주2) 신주인수권 행사가액 조정
당사는 2011년 01월 11일 아래와 같이 신주인수권 행사가액 조정을 하고, 이를 공시한 바 있습니다.
1. 사채에 관한 사항
 (1) 사채의 종류 : 엠케이전자 제1회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채
 (2) 사채의 권면총액 : 15,000,000,000원
 (3) 자금조달의 목적 : 시설자금 및 운영자금
 (4) 사채의 이율 : 표면이자율 3.0(%), 만기이자율 : 5.0(%)
 (5) 사채발행일 : 2009년 07월 08일
 (6) 사채만기일 : 2012년 07월 08일
2. 조정에 관한 사항
 (1) 조정전 행사가액 : 4,479원
 (2) 조정후 행사가액 : 4,210원
3. 행사가능주식수 변동
 (1) 조정전 행사가능 주식수 : 3,348,961주
 (2) 조정후 행사가는 주식수 : 3,562,945주
4. 조정사유 : 시가하락에 따른 신주인수권행사가액의 조정
5. 조정근거 및 방법 :
 (1) 조정근거
 사채발행일로부터 매3개월이 되는 날마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 거래량 가중평균가격, 1주일 거래량 가중평균가격, 기 산일 종가를 산술 평균한 가격과 기산일 종가 중 높은 가격이 본건 신주인수권부사 채의 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 행사가격은 최초행사가격(다만, 최초행사가격이 조정된 경우 그와 같이 조정된 행사가격)의 70%를 하회하지 못한다.
 (2) 조정방법
 ① 1개월 거래량 가중평균가격 : 4,189원
 ② 1주일 거래량 가중평균가격 : 4,232원
 ③ 기산일 종가(2011년 01월 07일) : 4,210원
 ④ (①+ ②+ ③)의 산술평균가격 : 4,210원
 ⑤ ④와 ③의 기산일 종가 중 높은 가격 : 4,210원
 ⑥ 조정전 행사가액 : 4,479원
 ⑦ ⑤의 가액이 ⑥의 조정전 행사가액을 하회할 경우 낮은가액 : 4,210원
6. 조정가액 적용일 : 2011년 01월 08일
7. 기타 참고할 사항 : 신주인수권부사채 발행 이후 최초의 시가하락에 따른 신주인 수권행사가객의 조정임

4. 주식의 총수 등

【주식의 총수 현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 주)

구 분		주식의 종류		비고
		보통주	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		54,000,000	54,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		19,259,351	19,259,351	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-
	1. 감자	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-
	4. 기타	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		19,259,351	19,259,351	-
Ⅴ. 자기주식수		584,547	584,547	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		18,674,804	18,674,804	-

【자기주식 취득 및 처분 현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
자본시장법상 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		주식매수 청구권 행사	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

			우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	584,101	-	-	-	584,101	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	584,101	-	-	-	584,101	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	446	-	-	-	446	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	584,547	-	-	-	584,547	-
			우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 2006년 총 584,547주(3.04%)를 취득하였으며, 이중 446주는 무상증자 단수주 취득을 통해, 584,101주는 신탁계약을 통해 간접취득하였습니다.

【자기주식 신탁계약등 체결・해지현황】

[2010. 12 31 현재] (단위 : 원)

구분	기초		체결(+)		해지(-)		기말		비고
	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	
특정금전신탁	4,000,000,000	1	-	-	-	-	4,000,000,000	1	-
자산운용회사와 체결한 신탁계약	-	-	-	-	-	-	-	-	-
투자회사와 체결한 주식 취득계약	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	4,000,000,000	1	-	-	-	-	4,000,000,000	1	-

주1) 2010년 12월 29일 상기 자기주식취득 신탁계약을 연장(2011년 07월 02일)하였습니다.

5. 의결권 현황

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 주)

구 분	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,259,351	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	584,547	자기주식
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D)	보통주	18,674,804	-
	우선주	-	-

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.
제 44 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 45 조 (이익소각)
① 회사는 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.
② 소각을 할 주식의 수량 및 소각의 방법 등 이익소각의 구체적 사항은 이사회의 결의로써 정한다.
제 46 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 46조 의 2 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분		제29기	제28기	제27기
주당액면가액 (원)		500	500	500
당기순이익 (백만원)		6,473	6,790	12,465
주당순이익 (원)		347	364	669
현금배당금총액 (백만원)		-	-	-
주식배당금총액 (백만원)		2,801	-	-
현금배당성향 (%)		43.3	-	-
현금배당수익률 (%)	보통주	3.7	-	-
	우선주	-	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	150	-	-
	우선주	-	-	-
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
우리나라의 본딩와이어 산업은 반도체 재료의 적정수요 미달과 Process Production 기술의 취약으로 1980년 말까지만 해도 80%를 수입에 의존하였으나, 1990년대 이후 양적 질적 측면에서 비약적으로 발전하여 현재는 국내 수요의 90% 이상을 충당하고 있습니다.
당사의 주력 제품인 본딩와이어(Bonding Wire)는 반도체 리드프레임과 실리콘 칩을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품으로서 반도체 생산에 없어서는 안되는 핵심 재료 중 하나이며, 머리카락 평균 굵기의 1/5 정도 되는 미세선으로 고강도이며 고열에서 오래 견딜 수 있는 기술력이 요구되는 제품입니다.
본딩와이어 산업은 산업용 금가공 분야에서 가장 정밀하고 기술 집약적인 산업으로서 기술 및 품질의 난이도로 인해 진입장벽이 매우 높은 산업입니다.
또한 당사의 생산제품인 솔더볼은 반도체 패키지와 PCB 기판을 접착하거나 FLIP CHIP에서 칩과 칩 사이를 연결하여 전기적 신호를 전달하는 재료로서 패키지의 고집적화와 고기능화에 따라 점점 수요가 증대하고 있습니다.
특히 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package), Flip Chip 패키지의 비중이 증가하면서 본격적인 성장궤도에 진입하고 있습니다.
솔더볼 산업 또한 친환경적이며 충격에 강한 무연 솔더볼 개발, 패키지의 소형화에 따른 마이크로 솔더볼 개발 등 패키지의 기술변화에 따른 신제품 개발이 절실히 요구되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
세계 본딩와이어 산업은 2003년부터 2007년까지 년평균 10.5%의 높은 성장률을 보여 왔으나, 2008년에는 메모리 반도체 공급 과다로 인한 가격하락과 하반기에 미국에서 시작된 전세계적인 금융위기로 인한 소비경기 침체로 2007년 대비 약 2.4% 시장이 감소되었고. 2009년 역시 약 10.0% 시장이 감소되었지만, 2010년은 반도체 시황 회복에 따라 약 12.0% 성장한 것으로 추정이 되며, 2011년은 약 4.0% 성장을 예상하고 있습니다.
또한 반도체시장 성장 전망 및 세계 반도체 출하량 전망은 다음과 같습니다.

【반도체시장 성장 전망 - 전년대비 매출액 성장율】

연구기관	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
WSTS	3.2%	-2.8%	-9.0%	32.7%	4.5%
SIA	3.8%	-2.8%	-9.0%	28.4%	6.3%
Gartner	2.9%	-5.4%	-9.6%	31.5%	4.6%
I-Suppli	4.1%	-5.4%	-9.0%	32.0%	5.1%

주1) 자료출처 : WSTS(2010년 12월), SIA(2010년 10월), Gartner(2010년 9월), I-Suppli(2010년 10월)

【세계 반도체 출하량 전망】

(단위 : 억개)

구분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
세계 반도체 출하량	1,511	1,553	1,446	1,863	2,049
전년대비 성장율	10.0%	2.8%	-6.9%	28.8%	10.0%

주1) 자료출처 :2007년~2010년 : WSTS Data, 2011년 : 회사 추정치

(3) 경기변동의 특성
본딩와이어와 솔더볼은 반도체 소재부품이므로 반도체산업의 경기변동과 연관성이 있습니다.
즉, 세계 반도체산업의 계절적 특성과 경제 단계별 특성, 반도체 수요 등에 연동됩니다.

(4) 경쟁요소
2007년 세계 본딩와이어 시장은 6개의 주요 공급업체가 전체 시장의 약 94%를 점유하고 있었으나, 2008년 8월 독일의 헤라우스와 미국의 Kulicke & Soffa가 합병으로 5개 주요 공급업체 구조로 재편되었습니다.
주요 공급 업체로는 독일의 헤라우스그룹(미국의 Kulicke & Soffa 포함), 일본의 다나까금속, 스미토모금속, 엠케이전자, 일본의 니폰(NIPPON) 금속 등입니다.
2010년 기준으로 당사의 세계시장 점유율은 약 17%로 추정하고 있습니다.
본딩와이어 기술은 본딩와이어의 미세화, 고강도화, 고신뢰성화로 인해 단기간에는 습득하기 어려운 기술이며, 가격경쟁력 역시 일종의 장치산업으로 볼 수 있는 동 산업부문의 특성상 진입이 어렵고, 진입한다 하더라도 기존업체와의 가격경쟁력에서 우위를 점하기가 힘들것으로 예상됩니다.
세계 솔더볼 시장은 높은 시장 성장과 높은 투자 수익률로 인해 전세계적으로 약 20여개 공급업체가 존재합니다.
주요 공급 업체로는 일본의 센쥬금속, 한국의 덕산하이메탈, 독일의 HENKEL, 엠케이전자, 일본의 니폰(NIPPON) 금속 등입니다.
2010년 기준으로 당사의 세계시장 점유율을 약 9%로 추정하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
본딩와이어의 소재는 주로 금(Gold)이 사용되며 알루미늄을 비롯하여 최근 구리와 팔라듐을 사용하기도 합니다.
금은 구리나 알루미늄보다 가격면에서 매우 비싸지만 본딩 속도가 양산성 면에서 2배 이상 유리한 이유로 현재 업계에서 약 90% 이상의 물량이 쓰이고 있습니다.
당사의 금(Gold) 구입은 호주의 ANZ, 일본의 소지쯔, 캐나다의 스카시아 모카타 등을 통하거나 국내종합상사를 통해 이루어지고 있으며, 가격은 국제시세에 따라 변동됩니다.
솔더볼의 소재는 주석, 은, 구리가 사용되며 재료의 구입은 국내 솔더 합금업체를 통해 이루어지고 있고, 가격은 국제시세에 따라 변동됩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제
"해당 사항 없음"

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 1982년에 설립되어 반도체 산업의 중추적인 역할을 담당하는 반도체 기초 재료인 세금선(Gold Bonding Wire)을 제조하는 회사로서, 국내 반도체 제조업체인 삼성전자, 하이닉스, 스태츠칩팩코리아, 암코 등에 본 제품을 자체 개발하여 공급함으로써 국가경제발전에 견인차 역할을 수행하였습니다.
1983년에는 한국기계연구소의 신기업 창출 Project로 선정되어 기업화를 구축하였고,
1985년에는 한국기술금융(주)를 통해 벤처 및 기술집약형 우수중소기업으로 선정되면서 본격적인 양산체제를 갖추었습니다.
1986년에는 기업부설연구소를 설립하여 국내반도체 기초재료분야의 취약성을 보완하고 개선하는 등 지속적인 연구개발에 주력한 결과 1992년에는 Low-Loop Type을 개발하였고,
1994년에는 Long-Loop Type의 신제품을 개발하였습니다.
신제품의 개발과 수출에 노력하여 1995년에는 제32회 무역의 날에 금탑산업훈장을 수상하였고, 1997년에는 공업기반 기술개발사업에 의한 Sputtering Target 기술개발을 완료하여 Target Plate의 핵심기술을 보유하게 됨으로써 동 분야의 사업에도 진출하여 지속적인 매출증대를 가져오고 있습니다.
1998년에는 미래형 반도체 패키지 BGA (Ball Grid Array)의 재료인 솔더볼(Solder Ball)의 양산에 성공하였고. 1999년에는 해외시장 개척에 따라 판매물량이 증가될 것을 대비하여, 신공장 증설 및 기계 설비를 대폭 확장하였으며. 리드프레임 변형 타입인 BGA Solder Ball을 개발하여 양산체제를 구축하였습니다.
2007년 6월에는 지식경제부(구, 산업자원부)가 시행하는 차세대 반도체 패키지용 초극세선 Bonding Wire의 개발사업자로 선정되어 경박단소화 되는 반도체 패키지 기술의 변화에 대응할 수 있는 기술을 선점하기 위한 연구개발활동을 활발히 진행하고 있습니다.
2008년 9월에는 세계최초로 금·은 합금와이어의 양산개발에 성공하여 기존 Gold Bonding Wire대비 25%정도 재료비를 줄일 수 있어 고객사의 원가절감에 기여하며 당사의 수익성을 개선하였고, 또한 2008년 12월에는 금·은 합금본딩와이어 제조기술이 지식경제부 기술표준원으로부터 2008년도 국가경쟁력 향상에 기여할 30대 신기술로 선정, 신기술 인증마크 (NET마크 : New Excellent Technology)를 부여 받은 바 있습니다.
2010년 당사의 매출액은 판매수량 확대에 따라 전년대비 29.6% 증가한 7,409억원을, 영업이익은 전년대비 11.7% 증가한 167억원을 시현하였습니다.
당사의 매출증대는 시장성장을 상회하는 실적이며, 그 요인은 해외시장 매출증대와 무연 솔더볼 판매비중 확대입니다.
특히 본딩와이어 해외 매출비중은 지속적으로 확대되고 있으며, 2010년 11월 5억불 수출탑을 수상한바 있습니다.
이러한 해외매출 증대는 해외영업 네트워크를 강화하고, 고객과 고신뢰성 본딩와이어 및 구리 와이어 등 신제품을 공동 개발하며, 고객들이 원하는 기술서비스를 신속, 정확하게 제공한 전략이 해외 고객들에게 인정받은 결과입니다.
또한, 6시그마 경영혁신을 통한 업계 최고 수준의 품질, 설비 자동화 및 공정 합리화를 통한 생산상 향상 등 고객에게 RealValue를 제공한 점도 매출 증대에 크게 기여하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
주요 생산품은 반도체용 Gold Bonding Wire(99.99%), 고순도 Gold Sputtering Target (99.999%), Gold합금 Sputtering Target, 고순도 Gold Evaporate Material (99.999%), BGA Solder Ball 등이 있습니다.

1) 반도체용 세금선(Gold Bonding Wire) - 칩과 리드프레임을 연결하는 미세 도선
* M Type (범용 Wire) : PLCC, PDIP, SOIC, SOJ, MQFP 등에 적용
* L Type (Low Loop Wire) : TSOP, TSSOP, TQFP 등에 적용
* T Type (Long Loop Wire) : BGA, POWER QUAD, SQFP 등에 적용
* R Type (고강도 Au-Pd 합금 Wire) : FINE PAD PITCH PKG, LONG LOOP PKG에 적용
* XC Type (초저 Loop Wire) : TSOP,MCP PKG등에 적용
* UB Type (4N 고강도 Wire) : FINE PAD PITCH PKG,MCP,MCM PKG 등에 적용
* UR Type (High Reliability Wire) : 20㎛이하 극세선 적용 PKG에서 고신뢰도 구현
* HR Type (4N,고순도 High Reliability Wire) : Green PKG,MCP 등 advanced PKG에 적용되며 4N(99.99%) 고순도 함량으로 최고 신뢰성 실현
* Au-Ag Alloy Wire : 금에 은을 15%~30% 합금화하여, Wire 가격을 10 - 25% 절감
* MR type (고신뢰성 Au-Ag wire) : 기존 Au-Ag wire의 취약점인, 고습/고온 신뢰성 기능을 대폭 향상시킨 bonding wire로서, Low Cost와 High Reliability를 동시에 실현한 세계 최초의 고신뢰성 Au-Ag wire
* Cu Bonding Wire - Wire 가격 절감 및 전기 전도도를 향상시키기 위한, 금의 대체재로서 Cu(구리)를 사용한 bonding wire
2) BGA CSP용 Solder Ball - 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하는 반도체 패키지용 재료
* Sn-Pb(Sn37Pb,Sn36Pb2Ag) : BGA,CSP,Flip Chip등에 이용
* Pb free(Sn3Ag0.5Cu,Sn4Ag0.5Cu) : Green PKG에 이용
* Low Ag, Pb-free Ball : Mobile Application PKG에 이용

(2) 시장점유율 등

(단위 : %)

구분		2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
국내시장	엠케이전자	38	39	39	44	45
	헤라우스	35	33	33	25	26
	기타	27	28	28	31	29

주1) 근거 : 회사추정치

(3) 시장의 특성
국내 반도체 패키징 시장은 초창기 저임금구조를 바탕으로 성장했으나, 이제는 고임금구조로 이미 전환됐고 기술력은 이미 세계 일류 수준입니다.
즉, CUSTOMER로부터 모든 작업사양서와 제반 재료를 받아 단순히 노동력만 투입하여 생산하는 수준을 넘어서 디바이스설계부터 CUSTOMER와 공동 참여하고, 해당 디바이스의 특성에 맞는 최적의 재료와 공정을 사용하는 첨단 업종으로 자리매김을 한 것입니다.
특히 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Size Package) 등 이른바 초박막 초소형 패키지시장은 휴대형 정보통신기기의 급속한 확산과 시스템 소형화 추세에 힘입어 지속적인 성장을 계속할 것으로 전망됩니다.
최근에는 지속적인 기술발전과 치열한 경쟁으로 인하여 기술주도형 산업으로 변신하여 더 작은 사이즈에 더 많은 용량을 수용하려는 반도체 업계의 요구를 앞서서 수용하기 위한 패키

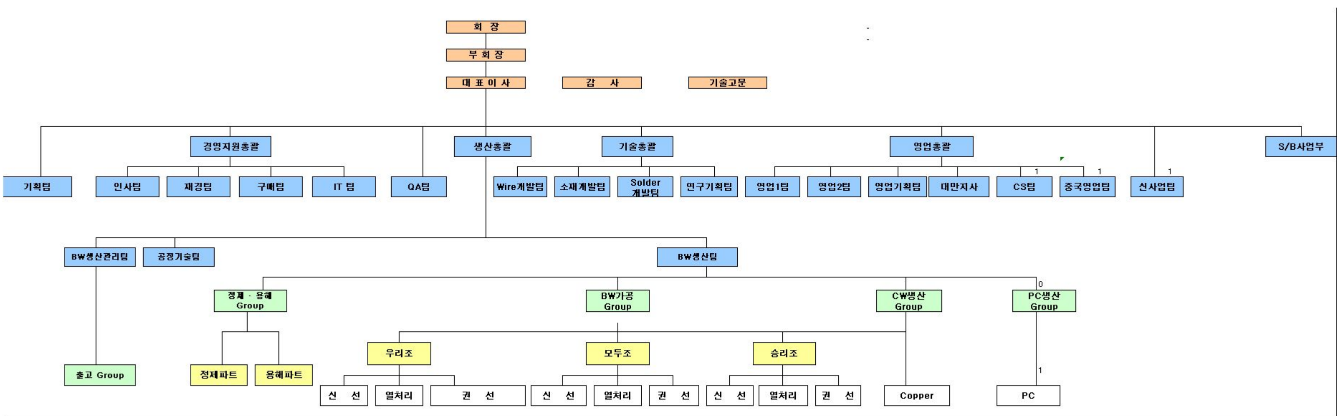
징 전문업체들의 소형 반도체 패키지 기술개발 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) Bonding Wire 분야 신규사업
① Au-Ag Wire
Au 재료비 절감을 위한 반도체 패키지용 Au-Ag Bonding Wire 합금설계 기술을 개발하고 고습 신뢰성 시험에서의 접합성 저하문제를 현저하게 개선 할 수 있게 되었으며, Au-Ag Wire 시장 선점을 통해 매출 및 수익성 확대에 기여할 예정입니다.
② PCC(Palladium Coated Copper) Wire
기존 bare Copper Wire의 산화 문제 및 작업성 증대 목적으로 bare Copper Wire에 Palladium을 Coating한 PCC Wire를 개발하여 시장에 프로모션 중입니다.
③ LED 패키지용 Wire
LED 패키지용 Wire의 경우 현재 엠케이전자가 국내 시장의 80% 이상을 선점한 관계로, LED시장 성장에 힘입어 향후 안정적인 매출기반을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
④ 중국공장
2009년 11월에 중국 곤산지역에 세계 최대 규모의 구리전용 본딩와이어 공장을 완공하고 양산에 들어갔으며, 중국공장이 가동될 경우 연간 생산규모가 현재 250만㎞에서 300만㎞로 확대될 예정이며, 향후 2~3년 내에 세계시장 점유율이 약 20%대 초반까지 증가할 것으로 보고 있습니다.

(나) 기타 추진중인 신규사업
① 2차전지
2차전지분야에서 국내 글로벌 전지회사와 공동으로 리튬이차전지용 차세대 음극 활물질 소재 개발을 추진하고 있으며. 현재 샘플 생산 설비 제작이 완료되었으며, 시험용 샘플 생산이 진행되고 있으며, 2010년 8월 당사가 참여하는 '고에너지 이차전지용 전극소재'컨소시엄이 지식경제부 세계시장 선점 10대 핵심소재(WPM)사업 참여기관으로 선정되었습니다.
② CNT광원
2010년 2월 탄소나노튜브(CNT) 전문기업 나노퍼시픽(주)의 경영권 인수를 통해 CNT 사업에 진출하였습니다. 나노퍼시픽은 CNT를 이용한 전계방출형 면광원 분야 선도기업으로 평가받고 있으며, CNT를 채용한 면광원은 균일도가 높고 발열이 낮으며 응답속도가 빠른데다 수은을 함유하지 않은 친환경광원이어서 차세대 광원으로 떠오르고 있으며, 당사는 CNT 광원사업을 신수종 사업으로 육성할 방침입니다.

(5) 조직도



2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체용 세금선 및 증착재료	제품	Bonding wire	본딩용Wire	-	693,086(93.55)
		Gold evaporate material	증착재료		27,500(3.71)
		Gold sputtering target	증착재료		11,412(1.54)
		Solder ball	Packing material		8,886(1.20)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/Km, g, KKea)

품목		제29기	제28기	제27기
Bonding wire	내수	336,193	301,131	253,921
	수출	304,182	274,593	242,876
Gold evaporate material	내수	42,908	36,921	26,562
	수출	45,278	39,215	31,786
Gold sputtering target	내수	44,483	40,832	30,657
	수출	-	-	35,017
Solder ball	내수	26,055	32,083	38,883
	수출	26,939	28,609	26,418

주1) 산출근거
① Gold bonding wire : 주문시점에 LBM(런던금시세)에 의한 사이즈별 중량의 원재료비에 가공비를 더하여 산출하였습니다.
② Gold evaporate material : 주문시점에 LBM(런던금시세)에 의한 무게별 중량의 원재료비에 가공비를 더하여 산출하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	비고
BondingWire 사업	원재료	Gold	반도체기초재료	701,006(99.34)	-
SolderBall 사업	원재료	Solder Bar	반도체기초재료	4,630(0.66)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : US$/Troz, 원/Kg)

품목	제29기	제28기	제27기
Gold	1,211.75	981.76	882.18
Solder Bar	40,576	33,645	23,815

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	제29기	제28기	제27기
공통	GBW	-	796,565	651,122	576,000
	GEM		51,253	44,437	35,160
	Target		104,599	93,552	70,320
	Solder Ball		18,016	8,500	7,800
합계			970,433	797,611	689,280

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등
① 산출기준
- 각 라인별 최대생산능력

② 산출방법
- 생산능력 = 기계대수 × 기계가동시간
- 기계가동시간 = 일가동시간 × 월가동일수 × 월수

(나) 평균가동시간
- 일평균 가동시간 : Gold bonding wire 23.6시간 / Solder ball 22.3시간
- 월평균 작업일수 : Gold bonding wire 27.3일 / Solder ball 24.4일

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	제29기	제28기	제27기
공통	GBW	-	677,370	510,742	370,508
	GEM		26,160	22,700	14,050
	Target		13,852	17,548	17,712
	SolderBall		6,961	5,103	4,835
합계			724,343	556,093	407,105

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : hr, %)

사업소(사업부문)	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률
Gold bonding wire	8,760	7,718	88.1%
Solder ball	8,760	6,530	74.5%

다. 생산설비의 현황 등

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고
					증가	감소			
공통	자가	용인시	토지	5,245	-	-	-	5,245	-
		안산시							

	건물	4,509		466	112	4,072	-
	구축물	1,450	36	553	100	1,070	-
	기계장치	5,635	3,166	176	1,940	6,856	-
	차량운반구	70	25	9	21	75	-
	공구와기구	2,134	729	538	615	2,235	-
	비품	447	249	16	234	461	-
	건설중인자산	2,180	11,372	7,053	-	6,499	-
합계		21,669	15,578	8,810	3,021	26,512	-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목		제29기	제28기	제27기
공통	제품	GBW	수출	414,749	314,261	226,724
			내수	277,939	208,708	182,576
			합계	692,688	522,970	409,300
		GEM	수출	9,791	9,208	4,582
			내수	17,708	13,869	10,335
			합계	27,500	23,076	14,917
		Target	수출	-	-	17
			내수	11,412	17,750	17,748
			합계	11,412	17,750	17,765
		SolderBall	수출	3,562	3,037	2,699
			내수	5,324	4,988	4,650
			합계	8,886	8,025	7,348
	로열티		수출	398	-	-
합계			수출	428,500	326,506	234,022
			내수	312,383	245,315	215,309

	합계	740,883	571,821	449,331

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직
- 영업총괄 : 전무1명
- 국내판매 : 영업1팀
- 해외판매 : 영업2팀 및 중국영업팀 및 현지 대리점
- 마케팅 : 영업기획팀

(2) 판매경로
- 본딩와이어
국내 : 거래처에 직판
수출 : 거래처에 직판 또는 대리점 통한 판매
- 솔더볼
국내 : 거래처에 직판
수출 : 거래처에 직판 또는 대리점 통한 판매
- 기타(EVM & Target)
거래처에 직판 또는 대리점 통한 판매

(3) 판매방법 및 조건
- 국내 : 납품후 현금결제 또는 세금계산서 발행후 업체별 Payment 조건에 따른 현금결제
- 해외 : 납품후 업체별 Payment 조건에 따른 현금결제

(4) 판매전략
- 신제품 도입 및 전담 영업/R&D조직 운영을 통한 해외 대형 거래선 개발 지속
- 해외 현지 영업 및 기술서비스 강화를 통한 해외 전략 거래선과의 안정적 사업 유지
- 고객 및 제품 MIX 전략을 통해 수익지향적 영업 전개
- 지속적인 기술협력 관계 유지
- 품질고급화
- 관련품목의 다변화

6. 수주상황

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고
Bonding Wire(km)	2010/01/01~ 2010/12/31	2010/01/01 ~ 2010/12/31	734,228	692,668	41,560
Solder Ball(KKEA)			9,152	8,886	267
GEM(gr)			29,171	27,520	1,651
Target(gr)			11,640	11,412	228

합계	784,191	740,485	43,706

7. 시장위험과 위험관리

가. 주요 시장위험 내용

당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.

나. 위험관리방식

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 세계 유수의 금융기관으로부터 환리스크 관리에 대한 컨설팅을 받았으며, 환위험 관리규정 제정, 사내선물환제도 도입 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다.

8. 파생상품거래 현황

가. 파생상품계약 체결 현황

회사는 환 위험 회피 및 원자재 가격 변동 위험 회피의 목적으로 파생상품을 거래하고 있으며, 당기말 현재 파생상품의 평가 내역은 다음과 같습니다.
파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익 및 기타포괄손익으로 인식하였습니다.
모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.
2010년 12월 31일 현재 통화선도 계약에 의해 거래이익 1,094백만원, 거래손실 193백만원과 평가이익 366백만원, 평가손실 526백만원이 발생하였습니다.
원재료 선물계약에 의해 발생된 이익은 4,345백만원, 손실은 622백만원으로 원가에 반영되었습니다.

(1) 통화선도계약
통화선도계약과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 통화선도 거래이익은 1,094백만원, 거래손실은 193백만원입니다.
통화선도 미결제약정 잔액과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 통화선도 평가이익은 366백만원, 평가손실은 526백만원입니다.

(단위 : 천불, 천원)

거래상대방	계약일	만기일	대상통화	약정환율	계약금액	평가이익(손실)	대금수수방법	계약내용
씨티은행	2010.01.01 ~ 2010.12.31	2011-01-31	USD	1,131.12	USD 23,000	-125,342	차액결제	미래 일정시점에 특정통화를 미리 정한 환율에 의해 매매하기로 계약 당사자간 합의한 거래
		2011-				-162,262		

		02-28						
		2011-03-31				33,123		
		중도청산이 가능하나 중도청산시 중도청산일 현재의 평가손익 정산 / 약정환율은 계약금액 평균						
SC제일은행	2010.01.01 ~ 2010.12.31	2011-01-31	USD	1,145.54	USD 37,000	196,674	차액결제	미래 일정시점에 특정통화를 미리 정한 환율에 의해 매매하기로 계약 당사자간 합의한 거래
		2011-02-28				-188,839		
		2011-03-31				9,098		
		2011-04-29				57,883		
		2011-05-26				19,588		
		중도청산이 가능하나 중도청산시 중도청산일 현재의 평가손익 정산 / 약정환율은 계약금액 평균						
평가손익계			평가이익			365,976		
			평가손실			-526,053		

(2) 금선물계약
금선물계약에 의해 발생된 이익은 4,345백만원, 손실은 622백만원입니다.
금선물 미결제약정 잔액과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 금선물 평가이익은 1,021 백만원 중 현금흐름위험회피 효과적이지 않은 부분 211 백만원은 당기손익으로, 196백만원은 법인세효과, 나머지 614 백만원은 기타포괄손익으로 반영되었습니다.

거래상대방	계약일	만기일	계약수량(Toz)	약정금액(USD)
외환선물	2010-11-17	2011-01-05	1,514.00	1337.8340
	2010-11-17	2011-01-05	500.00	1338.8850
	2010-11-18	2011-01-05	1,200.80	1351.0730
	2010-12-17	2011-02-09	4,822.20	1376.5280
	2010-12-16	2011-02-23	1,075.00	1381.9930
	2010-12-22	2011-02-23	539.00	1391.1330
	2010-12-23	2011-02-23	942.00	1376.7110
유진투자선물	2010-11-15	2011-01-11	3,214.80	1368.2530
	2010-11-23	2011-01-12	1,171.00	1362.8490

	2010-11-26	2011-01-12	639.00	1367.7300
	2010-12-06	2011-01-12	699.00	1412.9850
	2010-12-06	2011-01-12	581.00	1416.7390
	2010-12-08	2011-01-12	842.00	1396.4010
	2010-12-13	2011-01-12	890.20	1389.4720
	2010-12-14	2011-02-15	1,706.00	1407.3930
	2010-12-15	2011-02-15	703.00	1390.5830
	2010-12-23	2011-02-15	826.00	1385.9110
	2010-12-29	2011-02-15	297.00	1414.3750
	2010-12-30	2011-02-15	108.00	1413.2320

나. 리스크 관리에 관한 사항

(1) 리스크 관리의 목적
외화자산을 보유하고 있는 당사는 환율변동으로 인해 당사 손익에 영향을 받지 않기 위해 환관리정책을 시행하고 있습니다.

(2) 리스크 관리의 원칙
당사의 외화자산 포지션 변화에 따라 노출된 금액과 기간의 포지션 Hedge

(3) 리스크 관리규정 현황
당사는 외환 및 원재료 리스크 관리 규정을 보유하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.
- 외환리스크 관리목적
- 원재료 리스크 관리목적
- 담당조직 및 담당업무
- 노출된 리스크 범위의 정의
- 리스크 관리의 원칙(한도) 설정

(4) 리스크 관리조직 현황

담당부서명	담당인원	주요담당업무
재경팀 구매팀	총인원: 2명 ▷ 유경험자 - 3년이상 : 2명	- 환 포지션 점검 (기간별) - 외환 Hedge 거래 - 원재료 Hedge 거래 - 환 포지션 평가 및 손익 보고 - 외환거래 및 원재료 거래 기록 유지 - 파생상품 검토, 거래실행

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직
당사는 1982년 (주)미경사로 설립한 후 1986년 정부의 설립인가를 받아 기업부설연구소를 발족하였습니다.
당 연구소는 급속한 과학기술의 발전과 급변하는 국내외 경영환경에 능동적으로 대처하고자 창업시절부터 축적한 제품개발 및 가공기술 노하우를 바탕으로 신제품 개발, 제품 국산화 및 생산설비의 자체제작을 수행하고 있습니다.
당사의 기업부설 연구소는 차세대 신규 사업을 개발하기 위해 전담 팀을 운영하고 있으며, 석사 16명, 박사 2명을 포함하여 총인원 29명이 4개 팀을 이루어 활발한 연구활동을 하고 있습니다.

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과목		제29기	제28기	제27기	비고
원재료비		-	-	-	-
인건비		1,486,420	1,307,595	1,274,763	-
감가상각비		396,622	336,308	306,747	-
위탁용역비		-	-	-	-
기타		493,933	774,597	459,194	-
연구개발비용계		2,376,974	2,418,501	2,040,704	-
회계처리	판매비와관리비	-	-	-	-
	제조경비	2,310,356	2,169,501	2,015,704	-
	개발비(무형자산)	66,618	249,000	25,000	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.32%	0.42%	0.45%	-

나. 연구개발 실적

1985년 국내 순수 기술로 Gold bonding wire를 개발 및 상용화한 이래로 국내외 유수의 종합반도체 및 전세계 TOP5 IC 패키징 회사에 이를 판매하고 있으며, 1999년 국내 최초로 미래형 반도체 패키지인 BGA(Ball Grid Array)용 Solder ball을 개발하여 그 판매 규모를 매년 성장시키고 있습니다.
2001년에는 멀티미디어, 이동통신의 발달에 따른 패키지의 소형화, 고집적화 경향에 따라 소재 자체의 소형화가 급격하게 진전되어 보다 가는 size에서도 고성능을 보일 수 있는 고성능, 고강도 wire의 개발이 완료되었고, 500㎛ 이하 size의 Solder ball 개발이 완료되어 고객 인증 및 납품이 시작되었습니다.

2002년에는 환경의 중요성이 대두되면서 기존의 Solder ball에 납 성분이 포함되지 않은 환경 친화적인 새로운 Pb-free Solder ball이 개발 완료되어 양산체제를 갖추었으며, 200㎛ 이하의 Ultra Micro Solder ball 개발에도 성공하였습니다.
또한, 당 연구소에서는 차세대 반도체 패키지인 Flip Chip Package용 Bump wire를 개발 완료하여 고객 승인을 획득하여 양산에 돌입하였으며, 반도체 패키지에 사용되는 wire의 size가 점점 가늘어지는 기술 흐름에 발맞추어 15㎛ 이하의 초극세선 제조기술을 확보하는 등 기술 경쟁시대에 기술적 우위를 확보하려고 끊임없는 노력을 기울여 왔습니다.
2003년에는 전세계적으로 거세게 일고 있는 cost reduction 기술의 일환으로 Au-Ag alloy wire 및 Cu bonding wire가 시판되기 시작했습니다.
또한 세계 최초로 3N(99.9%)순도의 고신뢰성 wire(UR type)를 개발하여 대형 고객사에 납품 중이며, 2004년 후반기부터는 고신뢰성 wire의 수준을 한 단계 끌어올린 4N(99.99%) 고신뢰성 wire(HR type)를 개발하였습니다.
이는 기존 3N 고신뢰성 wire보다 전기적 특성 및 신뢰성 기능을 한층 보강한 제품입니다.
또한 2006년에는 기존 Au-Ag alloy wire의 취약점인 고습 신뢰성 부분을 해결한 MR type(Moisture Resistance, Au-Ag alloy wire)을 개발하였으며, 다른 cost reduction 기술인 Cu wire의 경우도 TO, SO 등 Discrete PKG에 본격적으로 적용 되기 시작하였습니다.
2007~2008년 들어 Discrete PKG 보다 cost reduction 효과가 큰 QFN, QFP, BGA, CSP 등 High-end PKG에 적용하기 위한 초저경도 Cu wire인 LV type을 개발하여 고객사의 활발한 평가가 시작되었으며, 더불어 세계 최초로 MR type에 대한 양산 및 판매가 시작되었습니다.
또다른 bonding 소재인 Ag wire 및 저융점 Solder ball을 개발하여 시장에 출시하였습니다.
2009년 극미세 size인 12㎛ Gold bonding wire 양산판매 및 High-end PKG를 대상으로 한 작업성이 향상된 new Cu wire(LVS type)의 본격적인 시장 공략이 시작되었으며, 기존 MR type의 작업성 저하 문제를 개선하기 위한 MRS type을 양산 판매하였습니다.
더불어 Solder ball의 경우, 300㎛ 이하 미세 size에 대한 양산이 확대되었습니다.
2010년부터 기존 bare Cu wire의 산화 문제 및 작업성 증대를 목적으로 bare Cu wire에 Pd을 coating한 PC wire의 개발을 완료하여 본격적으로 판매를 실시하고 있으며, Solder ball의 경우, Ni, Bi원소를 첨가하여 고온 열피로특성 및 내충격특성이 우수한 SAC2508Ni-Bi조성과 SAC108-Ti조성 Solder ball을 개발하여 양산 판매를 준비중이며, 초미세 피치를 갖는 패키징기술의 진행 상황에 유연한 대응을 위하여 70um 초미세 Solder ball 개발 및 양산체계를 체계적으로 진행하고 있습니다.
현재 본 연구소에서는 국내외 유수의 대학 및 연구소의 최고 전문가 그룹과 기술적인 교류를 진행하여, 이를 토대로 근본 원리에 대한 연구 및 제품 개발, 성능 향상을 추구함으로써 Bonding wire와 Solder ball에 대한 전세계 고객의 브레인 역할을 수행하고 있으며, 18건의 등록 특허와 50건 이상의 특허 출원, 7건의 상표권과 20여건의 발표 논문을 보유하고 있습니다.

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 천원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
은행	75,945,924	96,639,810	99,088,253	73,497,481	-
보험회사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-
여신전문금융회사	-	-	-	-	-
상호저축은행	15,000,000	-	-	15,000,000	신주인수권부사채
기타금융기관	-				-
금융기관합계	90,945,924	96,639,810	99,088,253	88,497,481	-
회사채(공모)	-	-	-	-	-
회사채(사모)	-	-	-	-	-
유상증자(공모)	-	-	-	-	-
유상증자(사모)	-	-	-	-	-
자산유동화(공모)	-	-	-	-	-
자산유동화(사모)	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
자본시장 합계	-	-	-	-	-
주주・임원・계열회사차입금	-	-	-	-	-
기타	140,000	-	140,000	-	삼성전자중소기업지원금
총계	91,085,924	96,639,810	99,228,253	88,497,481	-

(참고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원

사모 : - 백만원

[해외조달] (단위 : $)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
금융기관	-	-	-	-	-
해외증권(회사채)	-	-	-	-	-
해외증권(주식등)	-	-	-	-	-
자산유동화	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
총계	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2011년 01월 11일 상기 신주인수권부사채 15,000,000천원을 전량 취득후 소각하였습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제29기	제28기	제27기	제26기	제25기
[유동자산]	179,425,722	157,499,499	116,385,891	109,732,744	81,974,421
ㆍ당좌자산	129,155,589	113,575,505	84,350,133	71,154,674	55,667,820
ㆍ재고자산	50,270,133	43,923,993	32,035,759	38,578,070	26,306,601
[비유동자산]	40,363,225	31,796,982	22,787,851	23,142,572	16,483,692
ㆍ투자자산	9,356,562	6,740,158	3,408,186	4,302,303	1,002,671
ㆍ유형자산	26,511,745	21,668,743	16,547,058	16,097,620	13,815,278
ㆍ무형자산	356,057	446,206	309,516	394,576	240,107
ㆍ기타비유동자산	4,138,861	2,941,876	2,523,090	2,348,073	1,425,636
자산총계	219,788,947	189,296,481	139,173,743	132,875,317	98,458,113
[유동부채]	129,435,826	92,669,380	64,439,276	61,439,373	29,027,419
[비유동부채]	1,991,915	15,139,337	1,801,913	8,092,280	10,389,930
부채총계	131,427,741	107,808,717	66,241,189	69,531,653	39,417,349
[자본금]	9,629,676	9,629,676	9,604,676	9,604,676	6,451,500
[자본잉여금]	10,807,001	11,200,944	9,162,940	9,162,940	11,836,722
[자본조정]	△3,248,434	△3,342,398	△3,310,816	△3,490,274	△3,618,473
[기타포괄손익누계액]	631,244	△68,965	197,506	86,629	-
[이익잉여금]	70,541,719	64,068,507	57,278,248	47,979,693	44,371,015
자본총계	88,361,206	81,487,764	72,932,554	63,343,664	59,040,764
매출액	740,883,052	571,821,264	449,330,876	348,190,714	297,890,342
영업이익	16,741,767	14,981,923	24,328,926	10,472,976	9,637,698
계속사업이익	6,473,212	6,790,259	12,464,772	6,072,418	5,848,345
당기순이익	6,473,212	6,790,259	12,464,772	6,072,418	5,848,345

주1) Δ는 부(-)의 수치임

가. 당해 사업연도의 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석사항은 감사인의 감사보고서 상의 재무제표에 대한 주석사항과 동일합니다.

2. 재무제표 이용상의 유의점

가. 재무제표 작성기준

당사는 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며2009년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 재무제표 작성시 채택한 회계정책과동일한 회계정책을 적용하였습니다.

당사가 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 수익인식
당사의 수익은 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가치로 수익을 측정하고 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 재화의 소유에 따른위험과 효익의 대부분이 구매자에게 이전되고, 판매한 재화에 대하여 소유권이 있을 때 통상적으로 행사하는 정도의 관리나 효과적인 통제를 할 수 없으며, 수익금액 및 거래와 관련하여 발생했거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 인식하고 있습니다.

(2) 대손충당금
매출채권 등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 관련 자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(3) 재고자산
재고자산은 이동평균법 (미착품은 개별법)에 의한 취득원가로 평가하고, 재고자산의 시가가 장부금액보다 하락하여 발생한 평가손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 평가손실은 재고자산의 차감계정으로 표시하고 있습니다.

(4) 유가증권
종속회사, 지분법피투자회사, 조인트벤처에 대한 투자를 제외한 채무증권과 지분증권에 대해서 취득하는 시점에 만기보유증권, 매도가능증권, 단기매매증권으로 분류하고 보고기간종료일마다 분류의 적정성을 재검토하고 있습니다.

만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권은 단기매매증권으로, 그리고 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다.

당사는 유가증권의 취득원가를 유가증권 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대비용을 가산하여 산정하고 있습니다.
당사는 만기보유증권을 상각후취득원가로 평가하고, 단기매매증권과 매도가능증권은 공정

가액으로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다.

시장성 있는 유가증권의 평가는 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격은 대차대조표
일 현재의 종가로 하고 있습니다. 시장가격이 없는 채무증권의 경우에는 미래현금흐름을 합리적으로 추정하고, 공신력 있는 독립된 신용평가기관이 평가한 신용등급이 있는 경우에는 신용평가등급을 적절히 감안한 할인율을 사용하여 평가한 금액을 공정가치로 하고 있습니다
. 한편, 시장성이 없는 수익증권의 경우에는 펀드운용회사가 제시하는 수익증권의 매매기준가격을 공정가치로 하고 있습니다.

당사는 단기매매증권의 미실현보유손익을 당기손익항목으로 처리하고, 매도가능증권의 미실현보유손익을 매도가능증권평가손익(기타포괄손익누계액)으로 처리하고 있으며, 당해 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 당사는 만기보유증권의 만기액면가액과 취득원가의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법을 이용하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다.

당사는 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 보고기간종료일마다 평가하여 유가증권의 회수가능가액이 채무증권의 상각후취득원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는 감액이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 손상차손을 인식하여 당기손익에 반영하고 있습니다.

(5) 지분법적용투자주식
투자주식 중 중대한 영향력을 행사할 수 있는 주식은 지분법을 적용하여 평가한 가액으로 평가하고 있습니다. 지분법피투자회사의 순자산변동에 따른 지분의 변동액은 투자주식계정에 가감처리하며 그 변동의 원천에 따라 지분법손익(당기손익), 이익잉여금 또는 지분법자본변동(기타포괄손익)으로 처리하고 있습니다. 피투자회사의 결손누적으로 인하여 투자주식의 금액이 "0"인 상태가 되는 경우에는 지분법 적용을 중지하고 지분법적용투자주식을 "0"으로 처리하고 있습니다. 단, 당사가 지분법피투자회사에 대하여 우선주, 장기성채권 등과 같은 투자성격의 자산을 보유하고 있는 경우그러한 자산의 장부금액이 "0"이 될때까지 지분법피투자회사의 손실 등을 계속하여 반영하고 있습니다.

중대한 영향력을 행사할 수 있게 된 날 현재 취득원가가 피투자회사의 순자산가액의 공정가치에 대한 당사의 지분을 초과하는 금액은 발생연도부터 5년 동안 정액법으로상각하고 있으며, 미달하는 경우 그 미달액을 피투자회사의 비화폐성자산 중 상각가능자산에 해당하는 금액은 가중평균내용연수인 5년 동안 정액법으로 환입하고, 비상각자산에 해당하는 금액은 처분(비용화)되는 시점에 환입하고 있습니다. 또한, 투자주식의 취득시점에 지분법피투자회사의 식별가능한 자산·부채를 공정가치로 평가한 금액과 장부금액의 차이금액 중 당사의 지분율에 해당하는 금액은 당해 자산·부채에 대한 지분법피투자회사의 처리방법에 따라 상각 또는 환입하고 있습니다.

당사 및 지분법피투자회사간의 거래에서 발생한 손익에 당사의 지분율을 곱한 금액중 보고기간종료일 현재 보유자산의 장부금액에 반영되어있는 부분은 당사의 미실현손익으로 보아 미실현이익은 지분법적용투자주식에서 차감하고 미실현손실은 지분법적용투자주식에 가산하였습니다.

(6) 유형자산

당사는 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 매입원가에 취득부대비용을 가산하고 있습니다. 한편, 현물출자, 증여 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

당사는 유형자산의 감가상각에 아래의 내용연수 동안 정액법을 적용하고 있습니다.

구분	추정내용연수	구분	추정내용연수
건물	50년	차량운반구	5년
구축물	5~40년	공구와기구	6~9년
기계장치	6~9년	비품	4~10년

유형자산의 진부화 또는 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 유형자산의 미래 경제적 효익이 장부금액에 현저하게 미달할 가능성이 있고, 당해 유형자산의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에는 장부금액을 회수가능가액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.

(7) 무형자산
개발활동 관련 비용 중 일정요건을 충족하고 미래 경제적 효익이 확실한 비용은 개발비의 과목으로 무형자산으로 처리하며 이외의 경우에는 경상개발비의 과목으로 제조원가로 처리하고 있습니다.

당사는 무형자산으로 계상된 개발비를 관련 제품 등의 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 5년간 상각하고 있으며, 그 상각액을 제조원가로 처리하고 있습니다.

개발비를 제외한 무형자산은 당해 자산의 제작원가 또는 매입가액에 취득부대비용을가산한 가액을 취득원가로 계상하며, 당해 자산의 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 10년간 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한잔액으로 평가하고 있습니다.

자산의 진부화 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 무형자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하게 되는 경우에는 장부금액을 회수가능가액으로 조정하고, 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.

(8) 국고보조금
당사는 자산취득에 사용될 국고보조금을 받는 경우에는 관련 자산을 취득하기 전까지는 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의차감계정으로 회계처리하고, 관련 자산을 취득하는 시점에서 관련 자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다.
한편, 국고보조금을 사용하기 위하여 특정조건을 충족해야 하는 경우가 아닌 기타의 국고보조금을 받은 경우에는 주된 영업활동과 직접적인 관련성이 있다면 영업수익으로, 그렇지 않다면 영업외수익으로 회계처리하고 있으며, 대응되는 비용이 있는 경우에는 특정 비용과 상계처리하고 당기손익에 반영하고 있습니다.

(9) 퇴직급여충당부채
당사는 2009년부터 퇴직연금제도를 도입하였으며, 퇴직연금규약에 따라 퇴직연금제도의 설정 이후의 근무기간을 가입기간으로 하고 그 이전 근무기간에 대해서는 기존의 퇴직금제도를 그대로 유지하고 있습니다.

당사의 퇴직연금제도는 확정급여형 퇴직연금제도로서 수급요건을 갖춘 종업원은 퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 됩니다. 종업원이 퇴직하기 전에는 보고기간종료일 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 퇴직연금에 대한 수급요건 중 가입기간 요건을 갖추고 퇴사한 종업원이 퇴직연금의 수령을 선택한 경우에는 보고기간종료일이후 퇴직종업원에게 지급하여야 할 예상퇴직연금합계액을 보험수리적가정을 사용하여 추정하고, 만기가 비슷한 국공채의 매 보고기간말 현재 시장이자율에 기초하여 할인한 현재가치를 퇴직연금미지급금으로 계상하고 있습니다. 한편, 사망률과 같은 보험수리적 가정이 바뀌거나 시간의 경과에 따라 현재가치가 증가한 경우 퇴직급여로 비용처리하고 있습니다.

퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여 관련 부채, 즉 퇴직급여충당부채와 퇴직연금미지급금에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여관련 부채의 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

(10) 외화자산 및 부채의 환산
당사는 비화폐성 외화자산 및 부채는 당해 자산을 취득하거나 당해 부채를 부담한 당시의 환율을 적용하여 환산하고, 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간종료일 현재 서울외국환중개주식회사가 고시하는 매매기준율로 환산하고 있으며 환산손익은 당기손익으로 계상하고 있습니다.

(11) 신주인수권부사채
당사는 신주인수권부사채에 대하여 부채부분과 자본부분을 분리하여 회계처리하고 있습니다. 부채부분은 전환권 또는 신주인수권이 없는 일반사채의 공정가치로 인식하고 있으며, 일반사채의 공정가치는 만기일까지 기대되는 미래현금흐름의 현재가치로 측정하고 있습니다. 사채의 발행가액에서 부채부분을 차감한 금액인 자본부분을 전환권대가 또는 신주인수권대가로 자본잉여금에 계상하고 있습니다. 부채부분은 유효이자율법을 이용하여 상각하고 있으며, 자본부분은 최초 측정후 재측정하지 않습니다.

(12) 신주발행비와 사채발행비
당사는 신주발행비를 주식발행가액에서 조정하여 주식발행초과금에서 차감하고, 사채발행비를 사채발행가액에서 조정하여 사채할인발행차금 또는 사채할증발행차금에 가감하는 방법으로 처리하고 있습니다.

(13) 사채할인(할증)발행차금
당사는 사채할인(할증)발행차금을 사채발행시부터 최종상환시까지의 기간에 걸쳐 유효이자율법을 적용하여 상각(환입)하고, 동 상각(환입)액을 이자비용에 가산(차감)하여 처리하고 있습니다.

(14) 파생상품 및 위험회피회계
모든 파생상품은 최초 계약시와 매 보고기간종료일에 공정가치로 평가하고 있으며, 거래비용은 발생시에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 내재파생상품의 경제적 특성및 위험도와 주계약의 경제적 특성 및 위험도 사이에 명확하고 밀접한 관련성이 없고내재파생상품과 동일한 조건의 독립된 파생상품이 파생상품의 요건을 충족시키는 경우에는 내재파생상품을 주계약과 분리하여 회계처리하고 있습니다.

특정위험으로 인한 기존 자산, 부채, 또는 확정계약의 공정가액변동위험을 회피하기 위해서는 공정가액위험회피회계, 특정위험으로 인한 예상거래의 미래 현금흐름변동위험을 감소시키기 위해서는 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있습니다.
위험회피수단을 최초 지정하는 시점에 위험회피 종류, 위험관리의 목적, 위험회피전략을 공식적으로 문서화하고 있으며, 최초 지정 시점 및 매 보고기간종료일에 높은 위험회피효과가 있는지 여부에 대해서 평가하고 있습니다.

공정가액위험회피회계를 적용하는 경우에 위험회피수단의 평가손익(파생상품이 아닌 금융상품을 위험회피수단으로 지정한 경우에는 외화환산손익) 및 특정위험으로 인한 위험회피대상항목의 평가손익은 당기손익으로 처리하고 있습니다.

현금흐름위험회피회계를 적용하는 경우 예상거래의 미래현금흐름변동위험을 감소시키기 위하여 지정된 파생상품의 평가손익 (위험회피수단이 파생상품이 아닌 금융상품인 경우에는 외화위험으로 인한 외환차이 변동분) 중 위험회피에 효과적인 부분은 현금흐름위험회피파생상품평가손익(외화환산손익)으로 기타포괄손익누계액의 항목으로 계상한 후 예상거래의 종류에 따라 향후 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 회계연도에 당기손익으로 인식하거나, 예상거래가 발생시 관련 자산부채의 장부금액에서 가감하여 처리하고 있습니다. 위험회피수단이 청산, 소멸, 행사되어 위험회피회계가 중단되는 경우에도 기타포괄손익누계액항목의 향후 회계처리는 동일하며, 다만 위험회피대상 예상거래의 발생가능성이 불확실하여 현금흐름위험회피회계가 중단된 경우에는 이미 기타포괄손익누계액에 계상된 파생상품평가손익을 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(15) 주식기준보상
당사는 임직원 및 기타거래상대방에게 주식이나 주식선택권을 부여하고 있으며, 주식결제형 주식기준보상거래의 경우에는 제공받는 재화나 용역의 공정가치를 보상원가와 자본(자본조정)으로 회계처리하고 있습니다. 그러나 제공받는 재화나 용역의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없다면 부여한 지분상품의 공정가치에 기초하여 재화나 용역의 공정가치를 간접 측정하여 보상원가와 자본(자본조정)으로 회계처리하고 있습니다. 부여한 지분상품의 조건이 매우 복잡하여 측정기준일 현재의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 내재가

치로 측정하고 궁극적으로 가득된 지분상품의 수량과 일치하도록 추정치를 변경하고 있습니다.

(16) 법인세비용

법인세비용은 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 산출하고 있습니다. 법인세부담액은 법인세법 등의 법령에 의하여 각 회계연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계이며 전기 이전의 기간과 관련된 법인세부담액을 당기에 인식하는 법인세 추납액 또는 환급액이 포함됩니다. 자산·부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적차이와 이월공제가 가능한 세무상결손금와 세액공제 등에 대하여미래에 부담하게 될 법인세부담액과 미래에 경감될 법인세부담액을 각각 이연법인세부채 및 자산으로 인식하고 있습니다. 이연법인세는 일시적차이 등의 실현이 예상되는 회계연도에 적용되는 법인세율을 사용하여 측정하고 있습니다.

(17) 추정의 사용
한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 재무제표를 작성하기 위해서 당사는자산 및 부채의 금액, 충당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부가액, 매출채권, 재고자산, 이연법인세자산에 대한 평가, 파생금융상품에 대한 평가 등이 포함됩니다.이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있습니다.

나. 기업회계기준 등의 위반사항

(1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항
"해당 사항 없음"

(2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항
"해당 사항 없음"

다. 기타 유의하여야 할 사항

"해당 사항 없음"

라. 한국채택 국제회계기준의 도입 진행사항

(1) 한국채택국제회계기준 도입 준비계획 및 추진상황
회사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성할 예정입니다. 이를 위해 별도의 도입 추진팀을 구성하여 도입에 따른 영향을 사전분석과이에 따른 회계시스템 정비를 추진하고 있으며, 관계자에 대한 사내ㆍ외 교육을 실시하고 있습니다.

(2) 한국채택국제회계기준과 현행 회계기준과의 회계처리방법 차이 중 회사에 중요한 영향을 줄 것으로 예상되는 사항
회사가 2010년 1월 1일 및 2010년 12월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준을 적용한 재무제표를 작성하는 경우 현행 기업회계기준을 적용한 재무제표와 유의적인차이를 발생시킬 것으로 예상되는 부분은 다음과 같습니다. 이러한 부분은 발생할 모든 차이를 망라한것은 아니며 향후 추가적인 분석결과에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 유의적인 차이의 구체적인 영향을 실무적으로 구할 수 없는 경우도 있습니다.

구분	현행 기업회계기준	한국채택국제회계기준하의 회계정책
금융상품의 매각거래	금융자산의 양도에 관한 판단요건을 충족하는 경우 금융자산에 통제권이 이전된 것으로 보아 매각거래로 회계처리	K-IFRS 제1039호에 따라 금융자산의 위험과 보상, 통제, 지속적 관여 등의 순차적 기준에 의하여 제거 시점 및 인식범위를 판단
종업원급여	기업회계기준 제27조에 근거하여 보고기간말 현재 1년 이상 근무한 임직원 전원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 인식	K-IFRS 제1019호에 따라 확정급여채무는 인구통계적 변수와 재무적 변수를 반영하여 산출된 미래에 예상되는 퇴직급여를 적절한 할인율을 이용하여 평가일 기준의 현재가치로 할인. 당기발생한 모든 누적보험수리적 손익은 당사의 정책에 따라 자본에 반영. 누적유급휴가에 대하여 부채로 인식

종속기업, 공동지배기업 및 관계기업에 대한 투자	기업회계기준서 제15호에 따라 중대한 영향력을 가지는 회사에 대해 지분법을 적용	K-IFRS 제1101호의 선택규정에 따라 별도재무제표 작성시 해당 투자에 대해서 장부가액을 취득원가로 측정
파생상품	기업회계기준서 제 9호에 따라 신주인수권대가를 자본으로 분류	K-IFRS 제1039호에 따라 요건충족시 주계약에서 내재파생상품을 분리하여 파생상품회계처리
이연법인세	재무상태표상 분류에 따라 유동ㆍ비유동으로 구분하며, 대차대조표상 항목과 관련되지 않은 경우에는 예상 소멸시기에 따라 유동ㆍ비유동으로구분표시	재무상태표의 분류상 이연법인세자산ㆍ부채는 비유동으로 표시

(3) 연결대상기업의 변동
당사는 2011년도에 최초로 한국채택국제회계기준을 도입하므로 연결으로 인한 연결대상 종속회사의 증감내역은 존재하지 않습니다.

(4) 회사의 재무상태 및 경영성과에 미치는 영향
회사의 재무상태와 경영성과에 미치는 영향은 개별재무제표를 기준으로 작성된 것이며, 향후 추가적인 영향분석, 기준서 개정 등을 통하여 변동될 수 있습니다.

【2010년말 현재 재무상태 및 2010년 경영성과조정내역】

(단위 : 원)

구분	총자산	총부채	총자본	당기순이익	포괄손익
기존 K-GAAP	219,788,947,220	131,427,740,874	88,361,206,346	6,473,212,104	7,173,421,794
확정급여채무에 대한 보험수리적 평가 및 종업원 누적유급휴가	-	650,772,234	-650,772,234	-361,970,570	-354,747,332
금융자산의 양도	6,833,400,000	6,833,400,000	-	-	-
종속기업및관계기업투자	4,085,021,627	259,749,100	3,825,272,527	3,842,592,595	3,825,272,527
파생상품	-	1,790,650,040	-1,790,650,040	912,038,541	229,148,919
조정사항에 따른 법인세효과	-143,398,624	-613,608,231	470,209,607	-588,718,179	-588,718,179
조정액 합계	10,775,023,003	8,920,963,143	1,854,059,860	3,803,942,387	3,110,955,935
한국채택국제회계기준	230,563,970,223	140,348,704,017	90,215,266,206	10,277,154,491	10,284,377,729

3. 회계정보에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제29기	매출채권	101,548,352	812,387	0.80%
	미수금	6,351,986	729	0.01%
	대여금	5,931,743	-	0.00%
	합계	113,832,081	813,116	0.71%
제28기	매출채권	74,623,501	746,235	1.00%
	미수금	2,982,333	415	0.01%
	대여금	2,333,134	-	0.00%
	합계	79,938,968	746,650	0.93%
제27기	매출채권	46,452,656	464,527	1.00%
	미수금	3,185,311	397	0.01%
	대여금	5,228,838	-	0.00%
	합계	54,866,805	464,923	0.85%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 원)

구분	제29기	제28기	제27기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	746,649,534	464,923,350	603,576,276
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	66,466,161	281,726,184	-138,652,926
4. 기말 대손충당금 잔액합계	813,115,695	746,649,534	464,923,350

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사의 매출채권에 대한 대손충당금 설정은 "설정대상 채권의 장부가액 × 설정률"로

산출되며,이때 설정률은 대손실적률과 0.8% 중 큰 금액으로 하여, 현재는 0.8%를 대손실적률로 하고 있습니다.
그리고 매출채권중 화의채권은 100% 대손충당금을 설정하고 있습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구분		6월이하	6월초과 1년이하	1년초과 3년이하	3년초과	계
금액	일반	100,504	1,029	15	-	101,548
	특수관계자	-	-	-	-	-
	계	100,504	1,029	15	-	101,548
구성비율		98.97%	1.01%	0.02%	-	100.00%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제29기	제28기	제27기	비고
GBW GEM Target SolderBall	제품	30,164,143	22,251,353	17,485,350	-
	반제품	18,732,130	20,984,068	13,990,200	-
	원재료	904,553	360,200	427,907	-
	소계	49,800,826	43,595,621	31,903,456	-
합계	제품	30,164,143	22,251,353	17,485,350	-
	반제품	18,732,130	20,984,068	13,990,200	-
	원재료	904,553	360,200	427,907	-
	소계	49,800,826	43,595,621	31,903,456	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]		22.66%	23.03%	22.92%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		15.29회	14.46회	11.94회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등
1. 당사는 매월말 기준으로 결산을 하므로 매월 1일 재고자산의 실사를 실시함
2. 재경 담당자가 공정순으로 재고조사표를 가지고 Sampling하여 확인함
3. 년말 회계감사시에는 회계감사인 2인의 입회하에 년말재고자산 실사를 실시함
4. 실사일과 대차대조표일 사이의 차이는 일별 재고변동표와 생산라인 작업일지를 검토하여 확인함
5. 장기체화재고 없음

다. 최근 5사업연도의 회계기준 변경내용 및 그 사유

"해당 사항 없음"

라. 최근 5사업연도 중 당기순손실이 발생한 사업연도와 그 주요원인

"해당 사항 없음"

마. 최근 5사업연도 중 직전사업연도대비 당기순이익 증감율이 30% 이상이거나 흑자전환인 사업연도와 그 주요원인

- 제27기(2008년)
주요원인 : 금·은 합금와이어 및 구리본딩와이어등 신제품 매출증대
- 제28기(2009년)
주요원인 : 직전사업연도 대비 원화강세에 따른 공헌이익의 감소

바. 당해 사업연도의 시장성없는 지분성증권 평가 현황

(1) 공정가액으로 평가한 시장성 없는 지분성증권 내역
"해당 사항 없음"

(단위 : 원)

종류	발행회사	수량	취득원가	장부가액	공정가액	평가손익	
						당기손익	자본조정
-	-	-	-	-	-	-	-
합계			-	-	-	-	-

(2) 시장성 없는 지분성증권의 평가방법 등
"해당 사항 없음"

4. 재무제표

"XI. 부속명세서" 를 참조하시길 바랍니다.

5. 연결재무제표

가. 요약연결재무정보

"해당 사항 없음"

나. 연결재무제표 이용상의 유의점

"해당 사항 없음"

다. 연결재무제표

"해당 사항 없음"

6. 부문별 재무 현황

가. 사업부문별 재무정보

"해당 사항 없음"

나. 지역별 재무 정보

"해당 사항 없음"

7. 합병전·후의 재무제표

가. 합병의 개요

"해당 사항 없음"

나. 합병전·후의 재무제표

"해당 사항 없음"

다. 합병관련사항

"해당 사항 없음"

라. 우회상장 전후 재무예측치와 실적치 비교

"해당 사항 없음"

마. 재무예측치와 실적치간 차이발생 원인

"해당 사항 없음"

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

가. 감사인

제29기 연간	제28기 연간	제27기 연간
삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

나. 당해 사업연도의 감사절차 요약

No.	주요업무	기간	비고
1	2010년 제29기 연말회계감사	2011.01.25 ~ 2011.01.28	-
2	2010년 감사조회서 발송	2011.01.20	-
3	2010년 연말 재고자산 실사	2010.12.28	-
4	2010년 중간검토	2010.12.13~2010.12.15	-
5	2010년 반기검토	2010.07.26~2010.07.29	-

다. 감사의견

사업연도	감사(또는 검토)의견	지적사항등요약
제29기 연간	적정	지적 사항 없음
제28기 연간	적정	지적 사항 없음
제27기 연간	적정	지적 사항 없음

라. 특기사항 요약

사업연도	특기사항
제29기 연간	해당 사항 없음
제28기 연간	해당 사항 없음
제27기 연간	해당 사항 없음

2. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등

(1) 회계에 관한 감사
회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 세밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사하였습니다.

(2) 업무에 관한 감사
업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 업무에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 세밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 감사하였습니다.

3. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

"해당 사항 없음"

4. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항

가. 감사용역계약 체결현황

(단위 : 천원, hr)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간
제29기 연간	삼정회계법인	정규감사	55,312	532
제28기 연간	삼정회계법인	정규감사	55,000	499
제27기 연간	삼정회계법인	정규감사	52,000	525

나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

① 2010년 06월 01일 ~ 2010년 06월 15일 1차 IFRS컨설팅이 진행되었으며, 보수는 20,000천원이 지급되었습니다.
② 2011년 02월 20일 ~ 2011년 03월 18일 2차 IFRS컨설팅이 진행되었으며, 보수는 25,665천원이 지급되었습니다.

5. 기타

"해당 사항 없음"

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.
당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.
결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

나. 개요

2010년 세계경제는 세계 각국의 정부의 글로벌 양적 팽창 정책 덕분에 2008년~2009년 위기에서 벗어나 완연한 회복세에 접어들었습니다. 특히 한국경제는 세계 어느 국가보다도 모범적인 위기 탈출의 모습을 보였습니다. 상대적으로 빠른 회복세를 보였을 뿐만 아니라 수출과 설비투자를 중심으로 한 민간부문의 자생적 회복력이 성장을 주도하는 매우 양호한 모습을 보였습니다.
특히 엠케이전자는 지난 2010년 한 해 동안 지속가능경영을 목표로 성장 잠재력 확보, 기업체질 개선 및 경쟁력 강화, Globalization 가속화 등을 중점적으로 추진하였습니다. 그 결과 본딩와이어, 솔더볼 등의 반도체 소재분야 이외에 차세대 이차전지용 고용량 음극활물질, CNT 조명사업 등의 미래성장동력을 확보하여 사업다각화의 계기를 마련하게 되었습니다.
특히 이차전지용 고용량 음극활물질 사업은 작년 7월 WPM 10대 과제 중의 하나인 차량용 고에너지 2차전지용 전극 소재 개발과제의 참여기업으로 선정되어 전기자동차용 이차전지의 음극 소재 연구개발투자가 본격화되었으며, 2009년부터 추진해왔던 이차전지용 차세대 음극소재의 양산화 사업이 한층 더 탄력을 받게 되었습니다.
또한 기업체질의 개선 및 경쟁력 강화를 위해 전략적인 원가구조의 개선 및 제조능력의 극대화를 추진하여 세계 최고의 글로벌 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 최근 몇 년 동안 금값의 급격한 상승으로 인한 Gold Wire를 Low Cost Wire로 대체하고자 하는 고객의 Needs를 충족하기 위한 PCC Wire 제품을 전략적으로 출시하였으며, 솔더볼의 경우 기존 oil방식에서 Gas방식으로 제조프로세스로 변경함에 따라 기존보다 월등한 품질 및 원가경쟁력을 갖추게 되었습니다.
지난 한해 엠케이전자의 Bonding Wire 시장점유율은 2009년 대비 1.8%p 증가한 17.3%로 차지하였습니다. 이러한 결과는 Globalization 가속화의 일환으로 추진했던 시장점유율 확대 및 Global Biz & Sales Infra 구축을 통한 신규고객의 발굴과 고객구조의 다변화 등에 힘입어 이룩한 성과입니다.
최근 산업경쟁의 패러다임이 완제품.부품 위주의 downstream 분야에서 소재중심의

upstream 분야로 이동하고 있어 소재의 경쟁력이 완제품.부품의 성능과 부가가치를 좌우하는 핵심요소로 부각될 것입니다. 엠케이이전자는 이러한 산업 패러다임에 부응하기 위하여 반도체 소재분야의 연구개발을 한층 강화하여 본딩와이어와 솔더볼 사업에서의 세계 1위를 달성할 것입니다. 또한 반도체 소재분야에서 축적한 경험과 노하우를 바탕 삼아 차세대 유망산업인 이차전지용 고용량 음극활물질 사업화를 추진하여 세계 최강의 소재전문기업으로 거듭날 것입니다.
이에 당사는 선택과 집중을 통한 핵심역량 강화라는 경영방침을 적극적으로 실천하고자 합니다.
그것을 실천하는 추진방안으로서는,
첫 번째 본질적인 제품경쟁력 확보
두 번째 수익성 중시의 성장 및 효율성 극대화
세 번째 현장경영 실시
네 번째 품질경영 강화를 들 수 있습니다.
이 가운데 중점적으로 추진하고자 하는 실천과제는 품질경영입니다.
임직원의 사고, 일하는 마음가짐, 협업하는 태도, 또 회사가 지금까지 쌓아온 모든 시스템 자체 등을 고도화시켜 엠케이이전자의 시스템 및 자세를 새롭게 정립시키고자 합니다.
품질을 고도화하지 않고서는 지속성장을 담보할 수 없습니다.
매일 매일 남과 다른 차이를 만들어내고, 그 차이를 끊임없이 지속시켜 지속 성장하는 그러한 한 해가 될 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다.

다. 재무상태 및 영업실적

(1) 경영성과
매출액은 전년 대비 판매수량 확대에 따라 7,409억원을 영업이익 및 당기순이익은 전년 대비 원화강세에 따른 공헌이익의 감소에 따라 167억원 및 65억원이라는 경영성과를 기록하였습니다.

(단위 : 원)

구분	2010년(제29기)	2009년(제28기)	차이
매출액	740,883,052,357	571,821,264,398	169,061,787,959
매출원가	714,089,084,101	546,002,639,481	168,086,444,620
매출총이익	26,793,968,256	25,818,624,917	975,343,339
판매비와일반관리비	10,052,201,753	10,836,701,928	-784,500,175
영업이익	16,741,766,503	14,981,922,989	1,759,843,514
영업외수익	23,826,698,885	27,391,290,464	-3,564,591,579
영업외비용	31,838,428,964	32,701,576,485	-863,147,521
법인세차감전순이익	8,730,036,424	9,671,636,968	-941,600,544
법인세비용	2,256,824,320	2,881,377,529	-624,553,209

당기순이익	6,473,212,104	6,790,259,439	-317,047,335

① 매출 및 매출원가 분석
매출원가율이 2009년 95.5%에서 2010년 96.4%로 0.9%p 상승하였습니다. 이는 원화강세에 따른 공헌이익 감소와 주된 원재료인 금값이 상승하여 매출원가율 상승을 가져온 것입니다.
② 제품별 매출 비중
Gold Bonding Wire의 꾸준한 성장 및 외부변수(환율 및 금값)의 영향으로 Gold Bonding Wire의 매출비중이 90%를 상회하고 있습니다.
Cooper Bonding Wire 및 Au-Ag Wire, Solder Ball의 약진을 통해 지속적으로 시장점유율을 확대해 나갈 것입니다.

구분	2010년(제29기)	2009년(제28기)	2008년(제27기)
Gold Bonding Wire	93.6%	91.5%	91.1%
Gold Evaporate Material	3.7%	4.0%	3.3%
Gold Sputtering Target	1.5%	3.1%	4.0%
Solder Ball	1.2%	1.4%	1.6%

③ 생산능력
Bonding Wire의 경우 고속권선 적용 및 정상화, 직행률 향상을 통해, Solder Ball의 경우 포밍생산성 향상, 공정 통합을 통해 연간 생산능력을 증대하였습니다.

(2) 재무상태
2010년말 유동자산은 전년대비 219억원 증가한 1,794억원이며, 비유동자산은 전년대비 86억원 증가한 404억원입니다. 2010년말 유동부채는 368억원 증가한 1,294억원이며, 비유동부채는 131억원 감소한 20억원입니다. 2010년말 자본총계는 당기순이익 발생 등으로 69억원 증가한 884억원입니다.

(단위 : 원)

구분	2010년(제29기)	2009년(제28기)	차이
유동자산	179,425,722,088	157,499,498,876	21,926,223,212
비유동자산	40,363,225,132	31,796,981,989	8,566,243,143
자산총계	219,788,947,220	189,296,480,865	30,492,466,355
유동부채	129,435,825,532	92,669,380,371	36,766,445,161
비유동부채	1,991,915,342	15,139,336,873	-13,147,421,531
부채총계	131,427,740,874	107,808,717,244	23,619,023,630
자본금	9,629,675,500	9,629,675,500	-
자본잉여금	10,807,001,435	11,200,944,444	-393,943,009

자본조정	-3,248,434,255	-3,342,398,195	93,963,940
기타포괄손익누계액	631,244,389	-68,965,301	700,209,690
이익잉여금	70,541,719,277	64,068,507,173	6,473,212,104
자본총계	88,361,206,346	81,487,763,621	6,873,442,725
부채와자본총계	219,788,947,220	189,296,480,865	30,492,466,355

지속적인 판매물량의 증가에 따라 재고자산은 63억원이 늘었으며, 재고자산의 장부가액은 503억원 입니다.
2010년 매출채권 잔액은 1,015억원이며 2009년 잔액 대비 269억원이 증가하였으며 매출채권이 증가한 주요 원인은 전년 대비 4분기 매출액의 증가로 인한 것입니다.

라. 유동성 및 자금조달과 지출

당사의 현금은 영업활동을 통하여 54억원이 증가하고, 주요 투자활동을 통하여 221억원이 감소하고, 재무활동을 통하여 9억원이 감소하여, 전체적으로는 176억원의 현금이 감소하여, 기말기준으로 141억원의 현금이 계상되었습니다.
이는 판매물량의 증가에 따라 매출채권과 재고자산이 증가한데 기인하며, 부실채권도 거의 발생하지 않는다는 점을 감안해본다면 우려할 만한 상황은 아니라고 판단합니다.
2011년도에는 증축공사, Capa.증대, PCC(Palladium coated Copper wire) 투자 및 소재개발 등을 감안하여 약 174억원 수준의 투자를 예상하고 있습니다만 일정 수준 Capex.의 변동 가능성은 있을 수 있습니다.

(단위 : 원)

구분	2010년(제29기)	2009년(제28기)	차이
영업이익	16,741,766,503	14,981,922,989	1,759,843,514
영업활동으로인한현금흐름	5,379,646,176	-21,787,711,407	27,167,357,583
투자활동으로인한현금흐름	-22,118,784,553	-10,869,108,740	-11,249,675,813
재무활동으로인한현금흐름	-847,790,000	38,555,242,490	-39,403,032,490
기말의현금	14,088,897,191	31,675,825,568	-17,586,928,377

VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 4명의 비상근이사, 2명의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

"해당 사항 없음"

성명	사외이사여부	비고
-	-	-

다. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비고
김광연	칸서스 파트너스(주) 이사	-	-	-
곽시근	前 경찰공무원	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀 (담당자 : 이철환과장 ☎ 031-330-1911)

라. 이사회 운영규정의 주요내용

- 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집, 주주총회에 부의할 사항
- 경영일반에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경, 신규사업 또는 새로운 업종의 개발, 자금계획 및 예산운용
- 조직에 관한 사항 : 기구조직의 제정 및 개폐, 공장·사무소등의 설치 및 폐합, 중요한 사규사칙의 제정 및 폐합
- 인사, 노무에 관한 사항 : 직원의 모집 및 훈련의 기본방침, 급여체계
- 자산에 관한 사항 : 투자에 관한 사항, 중요한 계약의 체결, 중요한 재산의 취득 및 처분, 결손의 처분, 주요 시설의 신설 개폐
- 장기자금조달에 관한 사항 : 신주의 발행, 사체의 모집, 자금의 차입
- 이사회 자체에 관한 사항 : 이사 및 감사의 직위 위촉
- 기타 : 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항, 기타 법령 정관에 관한 사항

마. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	2010.02.11	타법인 출자의 건	가결	-
2	2010.02.17	채무보증의 건	가결	-
3	2010.03.03	제28기 결산 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-
4	2010.03.03	내부회계관리운영실태보고의 건 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	-
5	2010.07.02	자기주식취득신탁계약 연장의 건	가결	-
6	2010.07.29	Cu라인 이전의 건 내부회계관리운영실태보고의 건 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	-
7	2010.09.08	채무보증의 건	가결	-
8	2010.09.09	타법인 출자지분 처분의 건	가결	-
9	2010.10.14	신규시설 투자의 건	가결	-
10	2010.11.08	채무보증의 건	가결	-
11	2010.12.23	타법인 출자증권 취득의 건	가결	
12	2010.12.29	자기주식취득신탁계약 연장의 건	가결	-

바. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	비고
1	2010.02.11	2(2)	-
2	2010.02.17	2(1)	-
3	2010.03.03	2(2)	-
4	2010.03.03	2(2)	-
5	2010.07.02	2(1)	-
6	2010.07.29	2(2)	-
7	2010.09.08	2(1)	-
8	2010.09.09	2(2)	-
9	2010.10.14	2(1)	-

10	2010.11.08	2(1)	-
11	2010.12.23	2(2)	
12	2010.12.29	2(1)	

사. 이사회내의 위원회 구성현황

"해당 사항 없음"

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
-	-	-	-	-

아. 이사회내의 위원회 활동내역

"해당 사항 없음"

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의성명		
				A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)
				찬반여부		
-	-	-	-	-	-	-

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등
- 감사의 구성 : 감사는 1명이상으로 하며, 현재 상근감사 1명으로 구성되어 있으며, 감사위원회는 설치되어 있지 않음
- 감사의 선임 : 감사는 주주총회에서 선임함
- 감사의 직무 : 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 필요시 임시총회의 소집을 청구 할 수 있으며, 직무를 수행하기 위하여 필요한때에는 회사에 대하여 영업보고를 요구 및 내용의 확인을 위해 업무와 재산상태를 조사 할 수 있음.
- 감사록 : 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 함

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부
- 주요 이사회에 참석 및 주요경영상황에 대한 보고 청취후 심의
- 경영실적 및 재무상태에 대한 공정타당한 작성여부와, 회계이외 업무의 건전성을 감사
- 경영상의 중요한 사실을 이사로부터 보고 받으며, 그 사실에 대해 심의

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	비고
조만석	前 전라북도 행정공무원	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	2010.02.11	타법인 출자의 건	가결	-
2	2010.02.17	채무보증의 건	가결	-
3	2010.03.03	제28기 결산 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-
4	2010.03.03	내부회계관리운영실태보고의 건 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	-
5	2010.07.02	자기주식취득신탁계약 연장의 건	가결	-
6	2010.07.29	Cu라인 이전의 건 내부회계관리운영실태보고의 건 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결	-
7	2010.09.08	채무보증의 건	가결	-
8	2010.09.09	타법인 출자지분 처분의 건	가결	-
9	2010.10.14	신규시설 투자의 건	가결	-
10	2010.11.08	채무보증의 건	가결	-

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

"해당 사항 없음"

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

"해당 사항 없음"

다. 소수주주권의 행사여부

"해당 사항 없음

4. 계열회사 등의 현황

가. 기업집단의 명칭

(주)오션비홀딩스

나. 기업집단에 소속된 회사

① 2010년 10월 15일 (주)오션비홀딩스는 2010년 9월 28일 기준 재무상태표를 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 모두 충족하여 지주회사 설립인가를 득하였습니다.
② (주)오션비홀딩스는 코스닥상장사인 엠케이전자(주)와 (주)니트젠앤컴퍼니를 포함해 총 9개의 자회사를 두고 있으며 총 3개의 손자회사를 거느리고 있습니다.
③ 엠케이전자(주)는 비상장사인 유구광업(주), MK ELECTRON(H,K.), (주)나노퍼시픽을 자회사로 두고 있으며, 비상장사인 KUTTUU JEEK LLP, MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd.의 손자회사를 거느리고 있습니다.

【타법인출자 현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부가액	취득(처분) 수량	취득(처분) 금액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
유구광업(주)	-	지분취득	-	840,000	70.0	2,043,700	4,900,000	2,450,000	-2,167,789	5,740,000	94.1	2,325,911	3,887,043	-1,931,235
MK ELECTRON (H.K.)	-	지분취득	-	1,010,000	50.2	1,288,656	4,488,000	6,069,507	-1,657,483	5,498,000	91.7	5,700,680	21,999,960	-2,423,953
합 계				-	-	3,332,356	-	8,519,507	-3,825,272	-	-	8,026,591	-	-

주) 2010년 09월 16일 기보유중이던 (주)니트젠앤컴퍼니 2,420,000주는 전량 장외매도되었습니다.

VII. 주주에 관한 사항

【최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
(주)오션비홀딩스	본인	보통주	3,100,000	16.10	5,031,800	26.13	-
계		보통주	3,100,000	16.10	5,031,800	26.13	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

주) 2010년 09월 07일 (주)오션비홀딩스는 (주)신성건설이 보유한 1,931,800주(지분율 10.03%)를 장외매수하였습니다.

【최대주주 변동내역】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고
2005.12.29	에프지텐사모투자전문회사	3,402,530	52.03	-
2006.10.30	대우전자부품외 3인	2,980,752	23.1	-
2007.09.13	칸서스제구차유한회사	2,396,705	18.43	-
2007.10.29	노블레스산업외 3인	3,035,027	23.34	-
2009.03.06	(주)오션비홀딩스	3,100,000	16.14	-

【주식 소유현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	(주)오션비홀딩스	5,031,800	26.13%	-

	강도원	1,000,000	5.19%	-
우리사주조합		6,031,800	31.32%	-

【소액주주현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 주)

구 분	주주		보유주식		비 고
	주주수	비율	주식수	비율	
소액주주	4,192	99.8%	9,379,575	48.7%	-
전체	4,202	100%	19,259,351	100%	-

정관상 신주인수권의 내용	해당 사항 있음		
결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지		
주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 (8종)		
명의개서대리인	한국예탁결제원		
주주의 특전	해당 사항 없음	공고게재신문	머니투데이신문

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종류		2010년 07월	2010년 08월	2010년 09월	2010년 10월	2010년 11월	2010년 12월
보통주	최고	4,685	5,600	5,600	5,310	4,795	4,335
	최저	4,330	4,430	5,200	4,865	3,965	4,015
월간거래량		2,306,721	12,216,231	12,352,008	5,472,834	3,166,113	1,775,986

나. 해외증권시장

"해당 사항 없음"

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

【임원 현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
							보통주	우선주		
차정훈	1963.01	회장	등기임원	상근	이사회의장	엠케이전자(주) 회장	-	-	4년 1개월	2012.03.26
최양희	1967.09	부회장	미등기임원	상근	경영총괄	엠케이전자(주) 부회장	-	-	1년 11개월	-
최윤성	1963.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	엠케이전자(주) 부사장	-	-	4년 1개월	2012.03.26
이진	1960.08	전무이사	미등기임원	상근	영업총괄	엠케이전자(주)	-	-	24년 8개월	-
이재홍	1962.12	상무이사	미등기임원	상근	지원총괄	(주)신성건설 이사	-	-	4년 2개월	-
박상훈	1956.02	상무이사	미등기임원	상근	SB사업	(주)삼성전기	-	-	8년 6개월	-
문정탁	1967.01	이사	미등기임원	상근	기술총괄	엠케이전자(주)	-	-	5년 8개월	-
조융제	1960.02	이사	미등기임원	상근	영업기획	엠케이전자(주)	-	-	9년 1개월	-
안형기	1960.02	이사	미등기임원	상근	생산총괄	엠케이전자(주)	-	-	12년 7개월	-
차준관	1957.09	이사	등기임원	비상근	-	(주)신성건설 대표이사	-	-		2012.03.26
허상희	1963.10	이사	등기임원	비상근	-	(주)노블레스산업 대표이사	-	-		2012.03.26
오종근	1953.08	이사	등기임원	비상근	-	호원대 교수	-	-		2012.03.26
김광연	1971.03	사외이사	등기임원	비상근	-	칸서스파트너스(주) 이사	-	-		2012.03.26
곽시근	1947.08	사외이사	등기임원	비상근	-	경찰공무원	-	-	4년 1개월	2012.03.26
조만석	1962.02	감사	-	상근	감사	행정공무원	-	-	4년	2012.03.26

주) 상기 등기임원 및 감사는 2009년 03월 27일 중임되었으며, 임기 만료일은 중임일로 부

터 3년을 의미합니다.

【직원 현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수				평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	비 고
		정규직	계약직	기 타	합 계				
전체	남	82	89	21	192	7년 2개월	7,334,466,346	38,200,346	-
전체	녀	17	4	6	27	3년 10개월	770,466,390	28,535,792	-
합 계		99	93	27	219	6년 1개월	8,104,932,736	37,008,825	-

2. 임원의 보수 등

【이사ㆍ감사의 보수 현황】

(단위 : 원)

구 분	지급 총액	주총승인 금액	1인당 평균 지급액	주식매수선택권의 공정 가치 총액	비고
이사	1,299,268,420	2,200,000,000	118,115,311	409,573,000	-
감사	71,933,800	80,000,000	71,933,800	-	-

주1) 지급총액은 실지급기준으로 충당성 인건비 제외 기준이며, 주식매수선택권의 공정가치 총액은 반영되어 있지 않습니다.
주2) 주식매수선택권의 공정가치
① 주식매수선택권의 공정가치 총액 = (각 회차별 부여받은 주식매수선택권중 잔여수량 * 각 회차별 주식매수선택권의 공정가치)의 합계액
② 주식매수선택권 공정가치 산출방법 : 블랙숄즈모형
주3) 상기 비중은 전체 임직원에 대한 주식매수선택권의 공정가치총액 888,875,000원 가운데 현재 재직중인 임원의 주식매수선택권 공정가치총액 409,573,000원에 대한 비중을 의미합니다.

【주식매수선택권의 부여 및 행사현황】

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량			미행사 수량	행사기간	행사 가격

					부여	행사	취소			
송기룡	-	2005.03.18	신주발행	보통주	45,000	-	-	45,000	2008.03.18 ~ 2013.03.17	4,327
이근	-	2005.03.18	신주밣행	보통주	10,000	-	10,000	-	2008.03.18 ~ 2013.03.17	4,327
이진	미등기임원	2005.03.18	신주발행	보통주	10,000	-	-	10,000	2008.03.18 ~ 2013.03.17	4,327
박상훈	미등기임원	2005.03.18	신주발행	보통주	10,000	-	-	10,000	2008.03.18 ~ 2013.03.17	4,327
안형기外 18명	직원	2005.03.18	신주발행	보통주	610,000	-	6,000	55,000	2008.03.18 ~ 2013.03.17	4,327
최상용	-	2007.03.28	신주발행/자기주식교부	보통주	100,000	50,000	-	50,000	2009.03.28 ~2014.03.27	3,982
이진	미등기임원	2007.03.28	신주발행/자기주식교부	보통주	15,000	-	-	15,000	2009.03.28 ~2014.03.27	3,982
박상훈	미등기임원	2007.03.28	신주발행/자기주식교부	보통주	15,000	-	-	15,000	2009.03.28 ~2014.03.27	3,982
문정탁	미등기임원	2007.03.28	신주발행/자기주식교부	보통주	25,000	-	-	25,000	2009.03.28 ~2014.03.27	3,982
조융제外 20명	직원	2007.03.28	신주발행/자기주식교부	보통주	103,000	-	15,000	88,000	2009.03.28 ~2014.03.27	3,982
최윤성	등기임원	2010.03.26	신주발행/자기주식교부	보통주	100,000	-	-	100,000	2012.03.26 ~2017.03.25	5,698
박원우	직원	2010.03.26	신주발행/자기주식교부	보통주	5,000	-	-	5,000	2012.03.26 ~2017.03.25	5,698

주1) 2011년 03월 30일 제29기 정기주주총회에서 임원 1인에게 주식매수선택권 15,000주

(행사가격 : 4,384원)를 부여하였습니다.

IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주(그 특수관계인 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여(증권의 대여를 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직·간접적 거래 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	거래내용	제 29(당)기	제 28(전)기
중대한영향력을 행사하는회사	㈜오션비홀딩스(구, ㈜거암개발)	주식매각	3,184,720	-
지분법피투자회사	유구광업㈜	대여	1,580,000	1,379,700
		대여금회수	450,000	-
기타	MK ELECTRON (KunShan) Co., Ltd.	자산매각	1,042,203	1,947,615
기타	MK ELECTRON (KunShan) Co., Ltd.	매출	1,025,603	-
기타	나노퍼시픽㈜	대여	2,047,280	-

주1) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

제공받는자	지급보증액	담보권자
MK ELECTRON (KunShan) Co., Ltd.	USD 3,000,000	한국수출입은행
	USD 3,500,000	국민은행
	USD 5,000,000	SC제일은행
	CNY 30,000,000	한국산업은행 상해지점

2. 대주주와의 자산양수도 등

"해당 사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래

"해당 사항 없음"

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

"해당 사항 없음"

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

"해당 사항 없음"

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고
제29기 정기주주총회 (2011.03.30)	제1호 의안 : 제28기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-
제28기 정기주주총회 (2010.03.26)	제1호 의안 : 제28기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-
제27기 정기주주총회 (2009.03.27)	제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-
제26기 정기주주총회 (2008.03.27)	제1호 의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-
임시주주총회 (2007.12.20)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	-
제25기 정기주주총회 (2007.03.28)	제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 승인	-

3. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등

"해당 사항 없음"

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

【견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황】

"해당 사항 없음"

(기준일 : 2010. 12. 31) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

제공받는자	지급보증액	담보권자
MK ELECTRON (KunShan) Co., Ltd.	USD 3,000,000	한국수출입은행
	USD 3,500,000	국민은행
	USD 5,000,000	SC제일은행
	CNY 30,000,000	한국산업은행 상해지점

라. 채무인수약정 현황

"해당 사항 없음"

마. 기타의 우발부채 등

"해당 사항 없음"

4. 제재현황

"해당 사항 없음"

5. 공모자금 사용내역

【공모자금 사용내역】

"해당 사항 없음"

(기준일 : 2010.12.31) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황
-	-	-	-	-

【외국지주회사의 자회사 현황】

"해당 사항 없음"

(기준일 : 2010. 12. 31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후 금액
매출액	-	-	-	-	-	(-)	-
내부 매출액	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
순 매출액	-	-	-	-	-	-	-
영업손익	-	-	-	-	-	(-)	-
계속사업손익	-	-	-	-	-	(-)	-
당기순손익	-	-	-	-	-	(-)	-
자산총액	-	-	-	-	-	(-)	-
부채총액	-	-	-	-	-	(-)	-
자기자본	-	-	-	-	-	(-)	-
자본금	-	-	-	-	-	(-)	-
감사인	-	-	-	-	-	-	-
감사・검토 의견	-	-	-	-	-	-	-
비 고	-	-	-	-	-		-

XI. 재무제표 등

【재무상태표(대차대조표】

제29기 2010년 09월 30일 현재

제28기 2009년 12월 31일 현재

제27기 2008년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제29기	제28기	제27기
자산			
유동자산	179,425,722,088	157,499,498,876	116,385,891,488
당좌자산	129,155,589,392	113,575,505,488	84,350,132,987
현금및현금성자산	14,088,897,191	31,675,825,568	25,777,403,225
국고보조금	(371,415,903)	(443,725,991)	(676,359,142)
단기금융상품	15,138,850	15,138,850	165,138,850
단기대여금	5,637,060,060	2,026,275,093	4,908,381,460
단기투자자산	555,000	495,000	490,000
매출채권	101,548,352,027	74,623,500,903	46,452,655,967
대손충당금	(812,386,816)	(746,235,009)	(464,526,560)
미수금	6,351,985,607	2,982,332,933	3,185,310,861
대손충당금	(728,879)	(414,525)	(396,790)
미수수익	338,702,288	189,047,902	25,754,248
선급금	2,254,286,103	2,991,579,046	3,048,509,164
선급비용	105,143,864	261,685,718	99,543,696
이연법인세자산	0	0	1,828,228,008
재고자산	50,270,132,696	43,923,993,388	32,035,758,501
제품	30,164,142,544	22,251,353,216	17,485,349,849
반제품	18,732,130,642	20,984,068,152	13,990,199,600
원재료	798,086,541	303,154,578	372,154,302

부재료	106,466,689	57,045,442	55,752,685
저장품	469,306,280	328,372,000	132,302,065
비유동자산	40,363,225,132	31,796,981,989	22,787,851,074
투자자산	9,356,562,015	6,740,157,750	3,408,186,331
장기금융상품	58,947,250	6,450,000	1,500,000
장기투자증권	976,340,000	1,794,831,229	1,050,000
장기대여금	294,683,580	306,859,210	320,456,340
지분법적용투자주식	8,026,591,185	4,632,017,311	3,085,179,991
유형자산	26,511,745,037	21,668,742,923	16,547,058,104
토지	5,244,749,113	5,244,585,463	463,683,600
건물	5,345,091,239	5,811,221,152	5,811,221,152
감가상각누계액	(1,273,164,486)	(1,302,628,692)	(1,188,275,112)
구축물	1,703,724,778	2,220,190,753	2,159,740,753
감가상각누계액	(633,735,026)	(769,845,508)	(665,031,356)
기계장치	20,573,078,332	17,517,574,211	16,184,423,941
감가상각누계액	(13,416,234,157)	(11,582,531,487)	(10,163,501,472)
국고보조금	(301,178,346)	(300,013,397)	(42,700,502)
차량운반구	128,216,539	111,506,539	195,354,272
감가상각누계액	(53,682,702)	(41,664,746)	(111,374,319)
공구기구	4,324,278,257	4,132,986,747	3,272,204,195
감가상각누계액	(2,048,919,187)	(1,948,866,213)	(1,459,121,476)
국고보조금	(40,530,290)	(50,257,322)	0
비품	3,495,301,534	3,262,284,623	3,006,788,171
감가상각누계액	(3,033,857,870)	(2,814,910,394)	(2,505,256,604)
국고보조금	(313,171)	(562,927)	(812,683)
건설중인자산	6,498,920,480	2,179,674,121	1,589,715,544
무형자산	356,056,676	446,205,563	309,516,234
개발비	357,251,027	414,540,847	300,242,451
국고보조금	(27,125,000)	0	0

기타무형자산	25,930,649	31,664,716	9,273,783
기타비유동자산	4,138,861,404	2,941,875,753	2,523,090,405
보증금	2,243,950,364	1,351,141,785	1,133,110,074
회원권	1,552,652,283	1,552,652,283	1,140,486,283
이연법인세자산	342,258,757	38,081,685	249,494,048
자산총계	219,788,947,220	189,296,480,865	139,173,742,562
부채			
유동부채	129,435,825,532	92,669,380,371	64,439,276,185
매입채무	34,652,793,709	11,706,043,542	2,041,280,573
단기차입금	73,497,481,000	75,945,924,000	48,450,467,910
미지급금	2,801,811,215	3,352,995,387	1,257,746,589
미지급비용	240,293,823	276,106,119	99,835,494
예수금	326,183,140	480,347,070	541,278,730
선수금	89,134,485	86,136,838	65,704,324
미지급법인세	2,873,590,172	212,798,843	5,782,962,565
유동성사채	0	0	6,000,000,000
유동성장기부채	0	140,000,000	200,000,000
유동성신주인수권부사채	15,000,000,000	0	0
상환할증금(유동성신주인수권부사채)	963,302,573	0	0
사채할인발행차금(유동성신주인수권부사채)	(124,106,165)	0	0
신주인수권조정(유동성신주인수권부사채)	(1,498,266,651)	0	0
유동이연법인세부채	613,608,231	469,028,572	0
비유동부채	1,991,915,342	15,139,336,873	1,801,912,578
장기차입금	0	0	140,000,000
신주인수권부사채	0	15,000,000,000	0
상환할증금	0	963,302,573	0
사채할인발행차금	0	(196,094,479)	0
신주인수권조정	0	(2,367,342,681)	0
퇴직급여충당부채	4,662,182,040	3,889,057,730	3,517,377,097

국민연금전환금	(15,488,000)	(16,825,100)	(16,825,100)
퇴직보험예치금	0	0	(2,118,839,419)
퇴직연금운용자산	(3,023,578,698)	(2,501,561,170)	0
국고보조금예수금	368,800,000	368,800,000	280,200,000
부채총계	131,427,740,874	107,808,717,244	66,241,188,763
자본			
자본금	9,629,675,500	9,629,675,500	9,604,675,500
보통주자본금	9,629,675,500	9,629,675,500	9,604,675,500
자본잉여금	10,807,001,435	11,200,944,444	9,162,940,404
주식발행초과금	8,656,652,468	8,656,652,468	8,409,298,468
기타자본잉여금	753,641,936	753,641,936	753,641,936
신주인수권대가	1,396,707,031	1,790,650,040	0
자본조정	(3,248,434,255)	(3,342,398,195)	(3,310,815,854)
자기주식	(3,986,833,195)	(3,986,833,195)	(3,986,833,195)
주식선택권	738,398,940	644,435,000	676,017,341
기타포괄손익누계액	631,244,389	(68,965,301)	197,506,015
현금흐름위험회피파생상품평가이익	613,924,321	0	197,506,015
현금흐름위험회피파생상품평가손실	0	(68,965,301)	0
지분법자본변동	73,076,863	0	0
부의지분법자본변동	(55,756,795)	0	0
이익잉여금(결손금)	70,541,719,277	64,068,507,173	57,278,247,734
법정적립금	13,062,995,728	13,062,995,728	13,062,995,728
임의적립금	2,849,187,075	2,849,187,075	2,849,187,075
미처분이익잉여금(미처리결손금)	54,629,536,474	48,156,324,370	41,366,064,931
자본총계	88,361,206,346	81,487,763,621	72,932,553,799
부채와자본총계	219,788,947,220	189,296,480,865	139,173,742,562

【손익계산서】

제29기　2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지

제28기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지

제27기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제29기	제28기	제27기
매출액	740,883,052,357	571,821,264,398	449,330,875,995
국내매출	12,782,577,356	9,369,781,804	6,114,810,710
수출매출	727,702,360,873	562,451,482,594	443,216,065,285
기타매출액	398,114,128	0	0
매출원가	714,089,084,101	546,002,639,481	414,965,870,466
제품매출원가	714,089,084,101	546,002,639,481	414,965,870,466
기초제품재고액	22,251,353,216	17,485,349,849	26,952,172,883
당기제품제조원가	724,342,701,871	556,093,374,773	407,105,237,123
타계정으로대체	(2,340,828,442)	(5,324,731,925)	(1,606,189,691)
기말제품재고액	(30,164,142,544)	(22,251,353,216)	(17,485,349,849)
매출총이익(손실)	26,793,968,256	25,818,624,917	34,365,005,529
판매비와관리비	10,052,201,753	10,836,701,928	10,036,079,440
급여	3,621,074,920	4,548,625,727	3,964,119,110
퇴직급여	402,695,400	318,201,296	568,774,737
복리후생비	533,616,252	547,415,035	564,591,407
통신비	44,618,859	38,897,057	29,894,299
소모품비	13,934,145	12,718,103	21,704,898
여비교통비	428,444,192	506,819,354	383,369,291
회의비	11,148,613	12,669,972	12,539,483
차량유지비	388,568,932	370,599,790	310,950,346
수선비	4,792,046	961,182	615,673
교육훈련비	57,516,961	57,970,611	42,673,464
세금과공과	154,877,520	131,244,070	120,768,690
도서인쇄비	13,347,921	20,019,314	8,089,177
감가상각비	116,910,231	136,358,037	165,637,885

접대비	431,302,422	492,094,225	431,949,030
보험료	149,276,688	94,160,951	72,534,397
지급수수료	1,661,225,808	1,338,761,769	1,228,261,035
임차료	48,742,620	5,454,546	21,818,184
광고선전비	12,272,727	11,589,700	12,149,800
견본비	128,142,437	129,856,484	126,770,234
운반비	1,126,124,757	945,716,252	987,371,352
전력비	14,073,568	11,902,666	11,127,568
대손상각비	66,151,807	281,708,449	0
전산관리비	19,623,037	18,139,273	17,145,725
해외시장개척비	509,755,950	776,359,235	737,987,583
주식보상비용	93,963,940	28,458,830	195,236,072
영업이익(손실)	16,741,766,503	14,981,922,989	24,328,926,089
영업외수익	23,826,698,885	27,391,290,464	43,604,319,951
이자수익	720,187,061	627,749,606	529,201,400
외환차익	17,869,333,479	17,039,927,921	38,947,966,368
외화환산이익	2,361,349,987	2,408,128,537	1,098,168,281
선도거래이익	1,093,815,207	6,682,820,000	559,300,000
선도거래평가이익	613,520,820	420,538,963	2,327,670,923
유형자산처분이익	221,407,358	205,259,028	3,318,313
지분법적용투자주식처분이익	940,678,932	0	0
대손충당금환입	0	0	138,652,926
잡이익	6,406,041	6,866,409	41,740
영업외비용	31,838,428,964	32,701,576,485	50,035,999,545
이자비용	4,227,366,543	3,618,396,180	4,031,258,862
기타의대손상각비	314,354	17,735	0
외환차손	19,627,830,810	20,374,671,087	15,599,112,218
외화환산손실	617,061,679	366,259,352	10,939,638,472
선도거래손실	193,200,000	5,481,660,923	18,623,519,055

선도거래평가손실	566,459,646	279,501,576	0
지분법손실	4,186,868,555	1,637,882,680	784,175,553
유형자산처분손실	642,099,390	34,176,414	25,363,712
기타비유동자산손상차손	461,300,000	0	7,431,500
기부금	0	7,100,000	25,500,000
매출채권처분손실	1,280,025,229	901,910,409	0
기타영업외비용	29,000,000	0	0
잡손실	6,902,758	129	173
법인세비용차감전순이익(손실)	8,730,036,424	9,671,636,968	17,897,246,495
법인세비용	2,256,824,320	2,881,377,529	5,432,474,585
당기순이익(손실)	6,473,212,104	6,790,259,439	12,464,771,910
주당손익			
기본주당순이익(손실)	347원	364원	669원
희석주당순이익(손실)	342원	358원	663원

【이익잉여금처분계산서】

제29기 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2011년 03월 30일)

제28기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2010년 03월 26일)

제27기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2009년 03월 27일)

(단위 : 원)

과 목	제29기	제28기	제27기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	54,629,536,474	48,156,324,370	41,366,064,931
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	48,156,324,370	41,366,064,931	28,901,293,021
당기순이익(손실)	6,473,212,104	6,790,259,439	12,464,771,910
합계	54,629,536,474	48,156,324,370	41,366,064,931
이익잉여금처분액	3,081,342,660	0	0
이익준비금	280,122,060	0	0

기타법정적립금	0	0	0
배당금	2,801,220,600	0	0
현금배당	2,801,220,600	0	0
임의적립금	0	0	0
기업합리화적립금	0	0	0
재무구조개선적립금	0	0	0
연구및인력개발준비금	0	0	0
결손금처리액	0	0	0
임의적립금이입액	0	0	0
기업합리화적립금이입액	0	0	0
재무구조개선적립금이입액	0	0	0
기타법정적립금이입액	0	0	0
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	51,548,193,814	48,156,324,370	41,366,064,931

【자본변동표】

제29기　2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지

제28기　2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지

제27기　2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2008.01.01 (전전기초)	9,604,675,500	9,162,940,404	(3,490,273,505)	86,629,030	47,979,692,504	63,343,663,933
연차배당					(3,166,216,680)	(3,166,216,680)
무상증자						
당기순이익(손실)					12,464,771,910	12,464,771,910
자기주식취득						
주식선택권의행사						
주식보상비용의인식			179,457,651			179,457,651
매도가능증권평가손실						0

파생상품의평가				110,876,985		110,876,985
현금흐름위험회피파생상품평가이익						0
현금흐름위험회피파생상품평가손실						0
신주인수권대가						
지분법자본변동						
부의지분법자본변동						0
2008.12.31 (전전기말)	9,604,675,500	9,162,940,404	(3,310,815,854)	197,506,015	52,278,247,734	72,932,553,799
2009.01.01 (전기초)	9,604,675,500	9,162,940,404	(3,310,815,854)	197,506,015	52,278,247,734	72,932,553,799
연차배당						0
무상증자						0
당기순이익(손실)					6,790,259,439	6,790,259,439
자기주식취득						0
주식선택권의행사	25,000,000	247,354,000	(73,750,000)			198,604,000
주식보상비용의인식						42,167,659
매도가능증권평가손실						0
파생상품의평가						110,876,985
현금흐름위험회피파생상품평가이익						0
현금흐름위험회피파생상품평가손실						0
신주인수권대가		1,790,650,040				0
지분법자본변동						
부의지분법자본변동						
2009.12.31 (전기말)	9,629,675,500	11,200,944,444	(3,342,398,195)	(68,965,301)	64,068,507,173	81,487,763,621
2010.01.01 (당기초)	9,629,675,500	11,200,944,444	(3,342,398,195)	(68,965,301)	64,068,507,173	81,487,763,621
연차배당						
무상증자						
당기순이익(손실)					6,079,269,095	6,079,269,095
자기주식취득						

주식선택권의행사						
주식보상비용의인식			93,963,940			93,963,940
매도가능증권평가손실						
파생상품의평가				682,889,622		682,889,622
현금흐름위험회피파생상품평가이익						
현금흐름위험회피파생상품평가손실						
신주인수권대가						
지분법자본변동				73,076,863		73,076,863
부의지분법자본변동				(55,756,795)		(55,756,795)
2010.12.31 (당기말)	9,629,675,500	11,200,944,444	(3,248,434,255)	631,244,389	70,147,776,268	88,361,206,346

【현금흐름표】

제29기 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지

제28기 2009년 01월 01일 부터 2009년 12월 31일 까지

제27기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제29기	제28기	제27기
영업활동으로인한현금흐름	5,379,646,176	(21,787,711,407)	28,749,983,383
당기순이익(손실)	6,473,212,104	6,790,259,439	12,464,771,910
현금의유출이없는비용등의가산	11,735,186,312	6,848,357,253	15,741,395,545
대손상각비	66,151,807	281,708,449	0
감가상각비	3,021,214,953	2,932,522,941	2,785,370,142
무형자산상각비	156,766,887	137,310,671	110,060,338
이자비용	941,064,344	418,634,053	0
기타의대손상각비	314,354	17,735	0
외화환산손실	579,362,226	366,259,352	10,939,638,472
선도거래평가손실	566,459,646	279,501,576	0

지분법손실	4,186,868,555	1,637,882,680	784,175,553
유형자산처분손실	642,099,390	34,176,414	25,363,712
기타비유동자산손상차손	461,300,000	0	7,431,500
퇴직급여	1,019,620,210	718,175,723	909,898,177
주식보상비용	93,963,940	42,167,659	179,457,651
현금의유입이없는수익등의차감	(4,132,689,376)	(3,033,926,528)	(3,567,810,443)
외화환산이익	2,357,082,266	2,408,128,537	1,098,168,281
선도거래평가이익	613,520,820	420,538,963	2,327,670,923
지분법적용투자주식처분이익	940,678,932	0	0
유형자산처분이익	221,407,358	205,259,028	3,318,313
대손충당금환입	0	0	138,652,926
영업활동으로인한자산·부채의변동	(8,696,062,864)	(32,392,401,571)	4,111,626,371
매출채권의감소(증가)	(27,125,862,864)	(28,391,455,668)	10,024,627,664
미수금의감소(증가)	929,043,489	427,153,667	1,285,756,871
미수수익의감소(증가)	(149,654,386)	(163,293,654)	9,337,084
선급금의감소(증가)	737,292,943	56,930,118	(2,995,274,871)
선급비용의감소(증가)	156,541,854	(162,142,022)	(44,450,897)
이연법인세자산의감소(증가)	(304,177,072)	2,039,640,371	(1,753,665,541)
재고자산의감소(증가)	(6,346,139,308)	(11,888,234,887)	6,542,312,101
매입채무의증가(감소)	23,194,340,432	9,627,482,020	(11,165,741,126)
미지급금의증가(감소)	(1,048,718,800)	1,722,952,301	(1,493,877,887)
미지급비용의증가(감소)	(35,812,296)	176,270,625	(85,667,990)
예수금의증가(감소)	(154,163,930)	(60,931,660)	342,821,570
선수금의증가(감소)	2,997,647	20,432,514	41,704,324
미지급법인세의증가(감소)	2,266,848,320	(5,570,163,722)	4,558,823,569
이연법인세부채의증가(감소)	(51,422,565)	502,175,267	0
퇴직금의지급	(246,495,900)	(346,495,090)	(477,652,730)
국민연금전환금의감소(증가)	1,337,100	0	2,106,600
퇴직보험예치금의감소(증가)	(522,017,528)	(382,721,751)	(679,532,370)

투자활동으로인한현금흐름	(22,118,784,553)	(10,869,108,740)	(7,519,454,454)
투자활동으로인한현금유입액	2,685,054,537	7,661,012,247	1,342,104,699
단기금융상품의감소	0	150,000,000	0
단기투자자산의처분	495,000	490,000	460,000
단기대여금의감소	646,575,093	4,908,381,460	0
국고보조금의수령	200,555,945	511,600,000	670,400,000
장기대여금의감소	198,895,570	124,912,037	275,462,900
지분법적용투자주식의처분	300,000,000	0	0
보증금의감소	287,326,421	3,526,789	380,000,000
건물의처분	6,209,950	0	0
구축물의처분	6,055,050	0	0
기계장치의처분	906,917,949	9,228,182	11,363,636
차량운반구의처분	2,545,455	59,999,999	2,300,000
공구기구의처분	129,476,104	1,129,000	2,118,163
비품의처분	2,000	0	0
건설중인자산의처분	0	1,891,744,780	0
투자활동으로인한현금유출액	(24,803,839,090)	(18,530,120,987)	(8,861,559,153)
단기금융상품의증가	0	0	1,647,813,751
장기금융상품의증가	52,497,250	4,950,000	0
단기투자자산의취득	0	495,000	0
국고보조금의감소	174,352,033	294,767,969	350,640,303
단기대여금의증가	3,927,280,000	1,829,700,000	2,725,307,000
장기대여금의증가	516,800,000	307,890,000	324,393,000
장기투자증권의취득	470,720,000	1,793,781,229	0
지분법적용투자주식의취득	8,519,507,200	3,184,720,000	0
보증금의증가	1,180,135,000	221,558,500	465,969,199
토지의취득	163,650	4,780,901,863	0
회원권의증가	0	412,166,000	0
구축물의취득	36,400,000	10,800,000	5,750,000

기계장치의취득	718,923,700	587,803,000	465,640,000
공구기구의취득	654,330,000	805,703,410	637,230,400
비품의취득	248,566,911	174,496,452	100,019,753
건설중인자산의취득	8,304,163,346	4,095,387,564	2,138,795,747
기타무형자산의증가	0	25,000,000	0
재무활동으로인한현금흐름	(847,790,000)	38,555,242,490	(3,007,141,355)
재무활동으로인한현금유입액	75,238,134,000	44,615,242,490	672,908,297,195
단기차입금의차입	75,238,134,000	29,644,757,090	672,740,697,195
국고보조금예수금의증가	0	0	167,600,000
신주인수권부사채의발행	0	14,771,881,400	0
주식선택권의행사	0	198,604,000	0
재무활동으로인한현금유출액	(76,085,924,000)	(6,060,000,000)	(675,915,438,550)
단기차입금의상환	75,945,924,000	0	669,734,621,870
유동성장기부채의상환	140,000,000	6,060,000,000	3,014,600,000
배당금의지급	0	0	3,166,216,680
현금의증가(감소)	(17,586,928,377)	5,898,422,343	18,223,387,574
기초의현금	31,675,825,568	25,777,403,225	7,554,015,651
기말의현금	14,088,897,191	31,675,825,568	25,777,403,225

XII. 부속명세서

(1) 한국채택국제회계기준을 채택한 회사는 공시대상기간중 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 등을 기재하여야 하나 당사는 해당 사항이 없습니다.

(2) 유형자산 재평가를 시행한 회사는 공시대상기간중 유형자산의 공정가치와 그 평가방법 등을 기재하여야 하나 당사는 해당 사항이 없습니다

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

"해당 사항 없음"

2. 전문가와의 이해관계

"해당 사항 없음"